

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/003592

International filing date: 03 March 2005 (03.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2004-059106  
Filing date: 03 March 2004 (03.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 12 May 2005 (12.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

10.3.2005

日本特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日  
Date of Application: 2004年 3月 3日

出願番号  
Application Number: 特願2004-059106

パリ条約による外国への出願  
に用いる優先権の主張の基礎  
となる出願の国コードと出願  
番号  
The country code and number  
of your priority application,  
to be used for filing abroad  
under the Paris Convention, is

J P 2004-059106

出願人  
Applicant(s): 日立化成工業株式会社

2005年 4月19日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小川

洋

【書類名】 特許願  
【整理番号】 16700200  
【提出日】 平成16年 3月 3日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 H01L 23/00  
C08G 59/00  
C08L 63/00

【発明者】  
【住所又は居所】 茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式会社 総合研究所内  
【氏名】 赤城 清一

【発明者】  
【住所又は居所】 茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式会社 総合研究所内  
【氏名】 片寄 光雄

【特許出願人】  
【識別番号】 000004455  
【氏名又は名称】 日立化成工業株式会社  
【代表者】 長瀬 寧次  
【電話番号】 03-5381-2403  
【連絡先】 知的財産室

【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 010043  
【納付金額】 21,000円

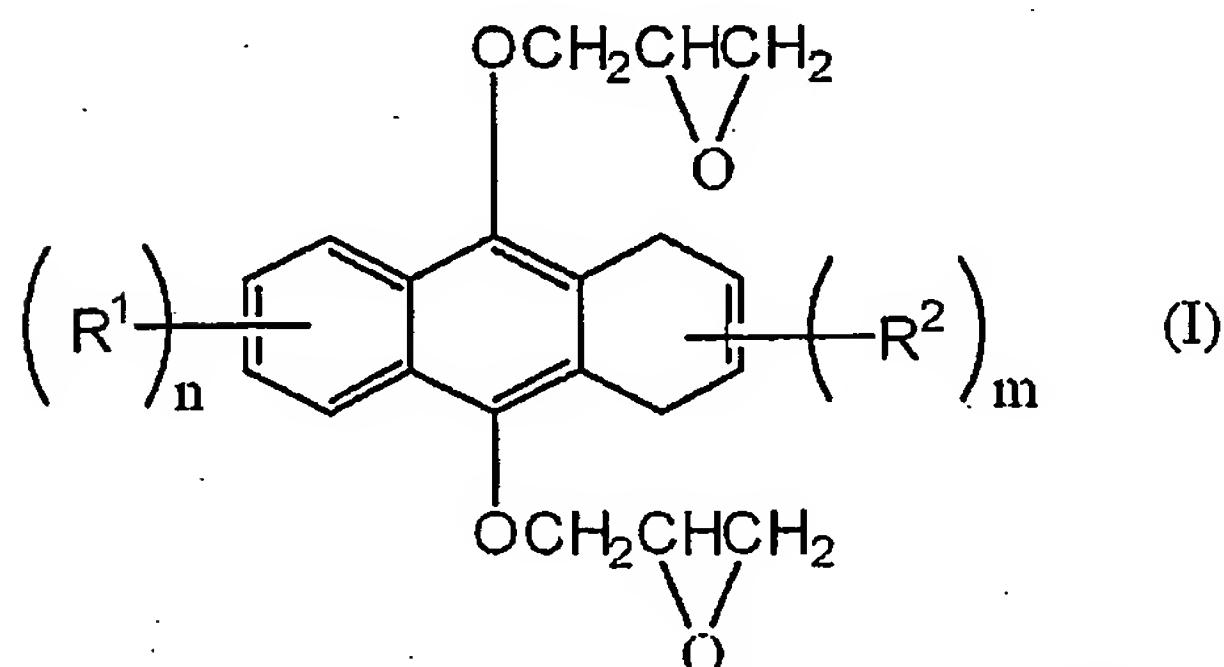
【提出物件の目録】  
【物件名】 特許請求の範囲 1  
【物件名】 明細書 1  
【物件名】 要約書 1

## 【書類名】特許請求の範囲

## 【請求項1】

(A) エポキシ樹脂、(B) 硬化剤を含有し、(A) エポキシ樹脂が下記一般式(I)で示される化合物を含有する封止用エポキシ樹脂成形材料。

## 【化1】

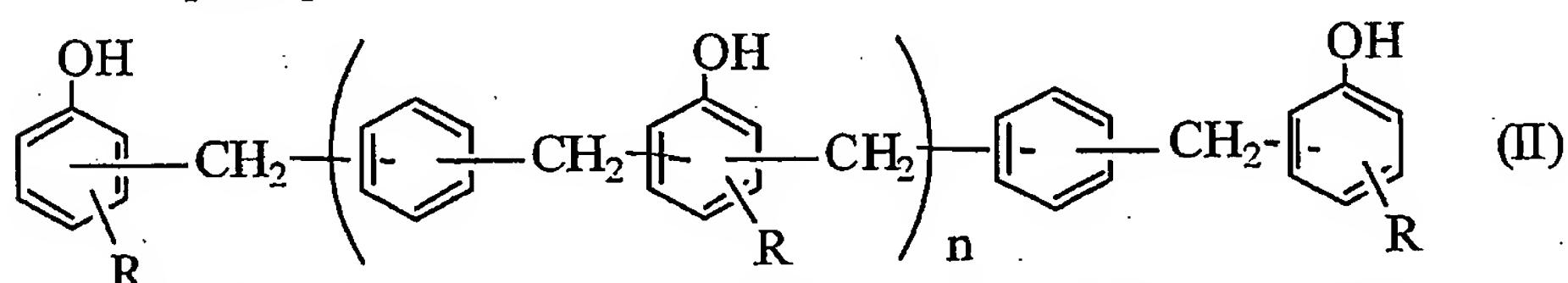


(一般式(I)中のR<sup>1</sup>は、置換又は非置換の炭素数1～12の炭化水素基及び置換又は非置換の炭素数1～12のアルコキシ基から選ばれ、全てが同一でも異なっていてもよい。nは0～4の整数を示す。またR<sup>2</sup>は、置換又は非置換の炭素数1～12の炭化水素基及び置換又は非置換の炭素数1～12のアルコキシ基から選ばれ、全てが同一でも異なっていてもよい。mは0～2の整数を示す。)

## 【請求項2】

(B) 硬化剤が下記一般式(II)で示される化合物を含有する請求項1記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

## 【化2】



(ここで、Rは水素原子及び炭素数1～10の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、nは0～10の整数を示す。)

## 【請求項3】

さらに(C) 硬化促進剤を含有する請求項1又は2いずれか記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

## 【請求項4】

(C) 硬化促進剤がトリフェニルホスフィンである請求項3記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

## 【請求項5】

(C) 硬化促進剤が第三ホスフィン化合物とキノン化合物との付加物である請求項3記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

## 【請求項6】

さらに(D) 無機充填剤を含有する請求項1～5いずれか記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

## 【請求項7】

(D) 無機充填剤の含有量が封止用エポキシ樹脂成形材料に対して60～95質量%である請求項6記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

## 【請求項8】

(D) 無機充填剤の含有量が封止用エポキシ樹脂成形材料に対して70～90質量%である請求項6又は7いずれか記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

## 【請求項9】

さらに (E) カップリング剤を含有する請求項 1～8 いずれか記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

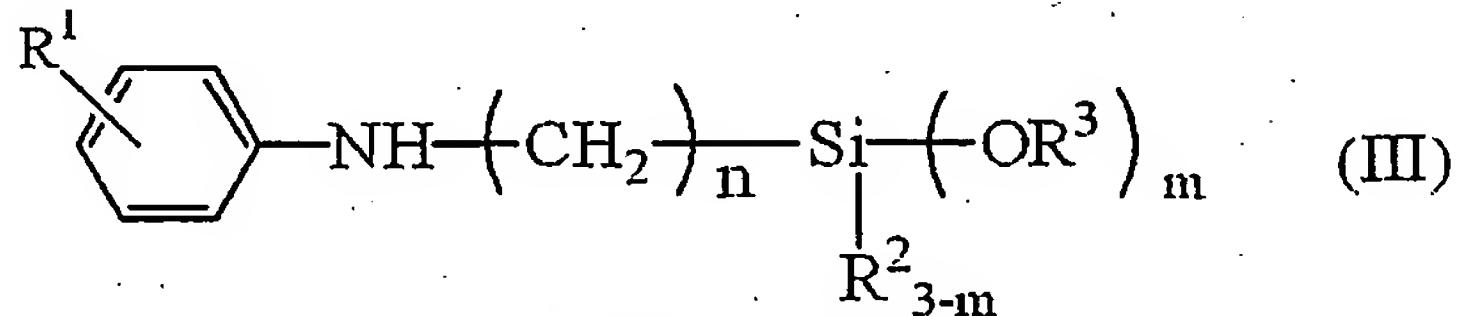
【請求項 10】

(E) カップリング剤が 2 級アミノ基を有するシランカップリング剤を含有する請求項 9 記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項 11】

2 級アミノ基を有するシランカップリング剤が下記一般式 (III) で示される化合物を含有する請求項 10 記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【化 3】



(ここで、 $\text{R}^1$  は水素原子、炭素数 1～6 のアルキル基及び炭素数 1～2 のアルコキシ基から選ばれ、 $\text{R}^2$  は炭素数 1～6 のアルキル基及びフェニル基から選ばれ、 $\text{R}^3$  はメチル基又はエチル基を示し、 $n$  は 1～6 の整数を示し、 $m$  は 1～3 の整数を示す。)

【請求項 12】

(A) エポキシ樹脂、(B) 硬化剤を予め溶融混合する請求項 1～11 いずれか記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項 13】

請求項 1～12 のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料で封止された素子を備えた電子部品装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】封止用エポキシ樹脂成形材料及び電子部品装置

【技術分野】

【0001】

本発明は、封止用エポキシ樹脂成形材料及びこの成形材料で封止した素子を備えた電子部品装置に関する。

【背景技術】

【0002】

従来から、トランジスタ、IC等の電子部品装置の素子封止の分野では生産性、コスト等の面から樹脂封止が主流となり、エポキシ樹脂成形材料が広く用いられている。この理由としては、エポキシ樹脂が電気特性、耐湿性、耐熱性、機械特性、インサート品との接着性などの諸特性にバランスがとれているためである。これらの封止用エポキシ樹脂成形材料の難燃化は主にテトラブロモビスフェノールAのジグリシジルエーテル等のブロム化樹脂と酸化アンチモンの組合せにより行われている。

近年、環境保護の観点からダイオキシン問題に端を発し、デカブロムをはじめとするハロゲン化樹脂やアンチモン化合物に量規制の動きがあり、封止用エポキシ樹脂成形材料についてもノンハロゲン化（ノンブロム化）及びノンアンチモン化の要求が出てきている。また、プラスチック封止ICの高温放置特性にブロム化合物が悪影響を及ぼすことが知られており、この観点からもブロム化樹脂量の低減が望まれている。

そこで、ブロム化樹脂や酸化アンチモンを用いずに難燃化を達成する手法としては、赤リンを用いる方法（例えば特許文献1参照。）、リン酸エステル化合物を用いる方法（例えば特許文献2参照。）、ホスファゼン化合物を用いる方法（例えば特許文献3参照。）、金属水酸化物を用いる方法（例えば特許文献4参照。）、金属水酸化物と金属酸化物を併用する方法（例えば特許文献5参照。）、フェロセン等のシクロペンタジエニル化合物（例えば特許文献6参照。）、アセチルアセトナート銅（例えば非特許文献1参照。）等の有機金属化合物を用いる方法などのハロゲン、アンチモン以外の難燃剤を用いる方法、充填剤の割合を高くする方法（例えば特許文献7参照。）、また最近では、難燃性の高い樹脂を使用する方法（例えば特許文献8参照。）等が試みられている。

【0003】

【特許文献1】特開平9-227765号公報

【特許文献2】特開平9-235449号公報

【特許文献3】特開平8-225714号公報

【特許文献4】特開平9-241483号公報

【特許文献5】特開平9-100337号公報

【特許文献6】特開平11-269349号公報

【非特許文献1】加藤寛、機能材料、11(6)、34(1991)

【特許文献7】特開平7-82343号公報

【特許文献8】特開平11-140277号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかしながら、封止用エポキシ樹脂成形材料に赤リンを用いた場合は耐湿性の低下の問題、リン酸エステル化合物やホスファゼン化合物を用いた場合は可塑化による成形性の低下や耐湿性の低下の問題、金属水酸化物を用いた場合は流動性や金型離型性の低下の問題、金属酸化物を用いた場合や、充填剤の割合を高くした場合は流動性の低下の問題がそれである。また、アセチルアセトナート銅等の有機金属化合物を用いた場合は、硬化反応を阻害し成形性が低下する問題がある。さらにはこれまで発明された難燃性の高い樹脂を使用する方法では、難燃性が電子部品装置の材料に求められるUL-94 V-0を十分に満足するものではなかった。

以上のようにこれらノンハロゲン、ノンアンチモン系の難燃剤、充填剤の割合を高くす

る方法及び難燃性の高い樹脂を使用する方法では、いずれの場合もブロム化樹脂と酸化アンチモンを併用した封止用エポキシ樹脂成形材料と同等の成形性、信頼性及び難燃性を得るに至っていない。

本発明はかかる状況に鑑みなされたもので、ノンハロゲンかつノンアンチモンで、成形性、耐リフロー性、耐湿性及び高温放置特性等の信頼性を低下させずに難燃性が良好な封止用エポキシ樹脂材料、及びこれにより封止した素子を備えた電子部品装置を提供しようとするものである。

【課題を解決するための手段】

【0005】

本発明者らは上記の課題を解決するために銳意検討を重ねた結果、特定のエポキシ樹脂を配合した封止用エポキシ樹脂成形材料により上記の目的を達成しうることを見い出し、本発明を完成するに至った。

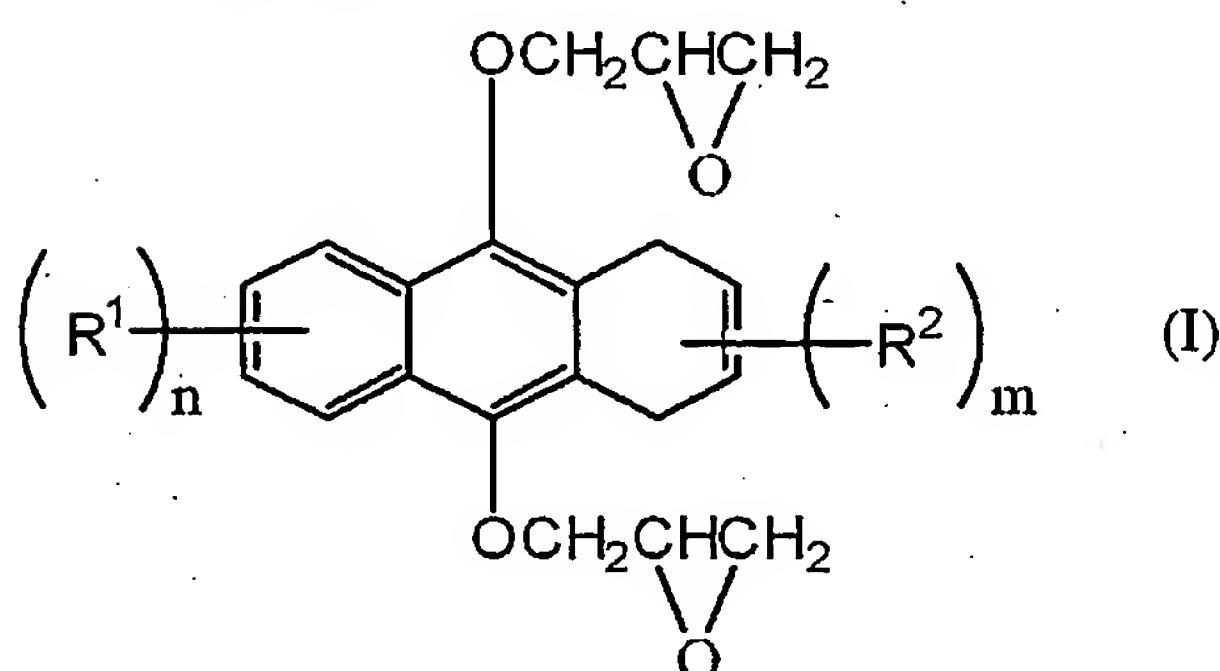
【0006】

本願は以下の発明に関する。

(1) (A) エポキシ樹脂、(B) 硬化剤を含有し、(A) エポキシ樹脂が下記一般式(I)で示される化合物を含有する封止用エポキシ樹脂成形材料。

【0007】

【化1】

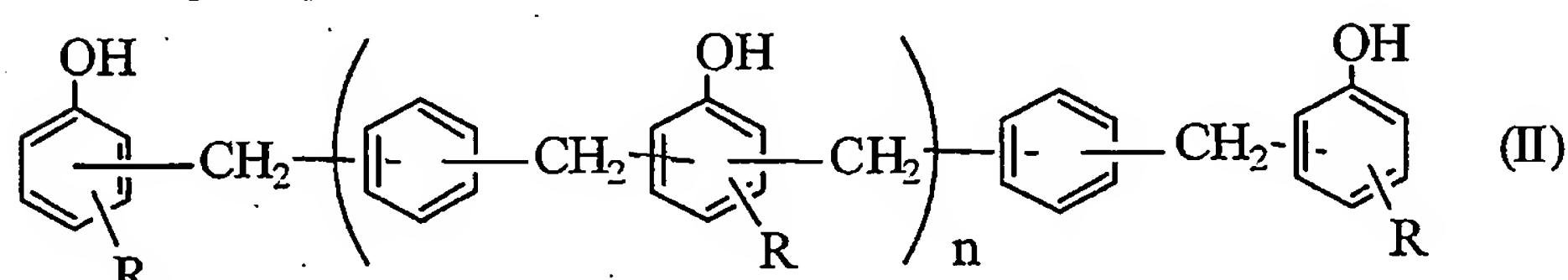


(一般式(I)中のR<sup>1</sup>は、置換又は非置換の炭素数1～12の炭化水素基及び置換又は非置換の炭素数1～12のアルコキシ基から選ばれ、全てが同一でも異なっていてもよい。nは0～4の整数を示す。またR<sup>2</sup>は、置換又は非置換の炭素数1～12の炭化水素基及び置換又は非置換の炭素数1～12のアルコキシ基から選ばれ、全てが同一でも異なっていてもよい。mは0～6の整数を示す。)

(2) (B) 硬化剤が下記一般式(II)で示される化合物を含有する上記(1)記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【0008】

【化2】



(ここで、Rは水素原子及び炭素数1～10の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、nは0～10の整数を示す。)

(3) さらに(C) 硬化促進剤を含有する上記(1)又は(2)いずれか記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

(4) (C) 硬化促進剤がトリフェニルホスフィンである上記(3)記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

(5) (C) 硬化促進剤が第三ホスフィン化合物とキノン化合物との付加物である上記(3)記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

(6) さらに (D) 無機充填剤を含有する上記 (1) ~ (5) いずれか記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

(7) (D) 無機充填剤の含有量が封止用エポキシ樹脂成形材料に対して 60 ~ 95 質量 % である上記 (6) 記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

(8) (D) 無機充填剤の含有量が封止用エポキシ樹脂成形材料に対して 70 ~ 90 質量 % である上記 (6) 又は (7) いずれか記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

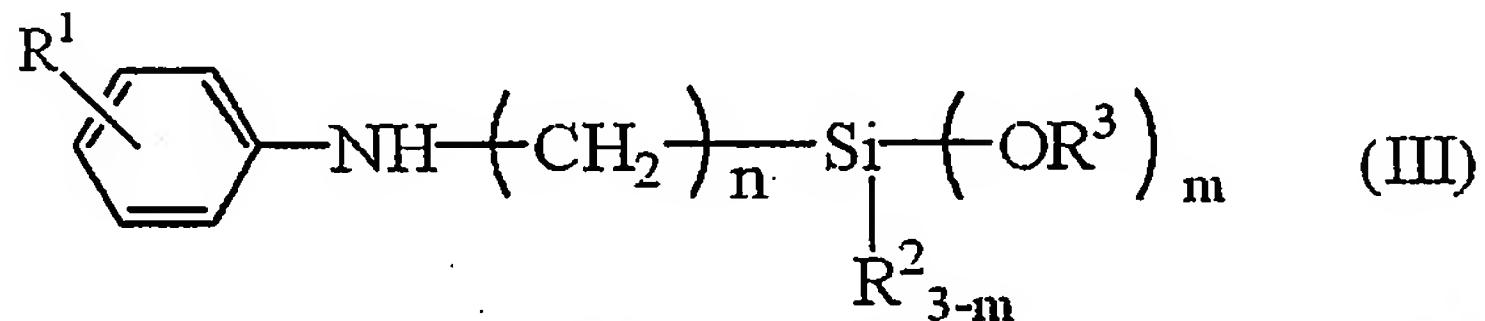
(9) さらに (E) カップリング剤を含有する上記 (1) ~ (8) いずれか記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

(10) (E) カップリング剤が 2 級アミノ基を有するシランカップリング剤を含有する上記 (9) 記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

(11) 2 級アミノ基を有するシランカップリング剤が下記一般式 (III) で示される化合物を含有する上記 (10) 記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【0009】

【化3】



(ここで、 $R^1$  は水素原子、炭素数 1 ~ 6 のアルキル基及び炭素数 1 ~ 2 のアルコキシ基から選ばれ、 $R^2$  は炭素数 1 ~ 6 のアルキル基及びフェニル基から選ばれ、 $R^3$  はメチル基又はエチル基を示し、 $n$  は 1 ~ 6 の整数を示し、 $m$  は 1 ~ 3 の整数を示す。)

(12) (A) エポキシ樹脂、(B) 硬化剤を予め溶融混合する上記 (1) ~ (11) いずれか記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

(13) 上記 (1) ~ (12) のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料で封止された素子を備えた電子部品装置。

【発明の効果】

【0010】

本発明による封止用エポキシ樹脂成形材料は難燃性が良好な電子部品装置等の製品を得ることができ、その工業的価値は大である。

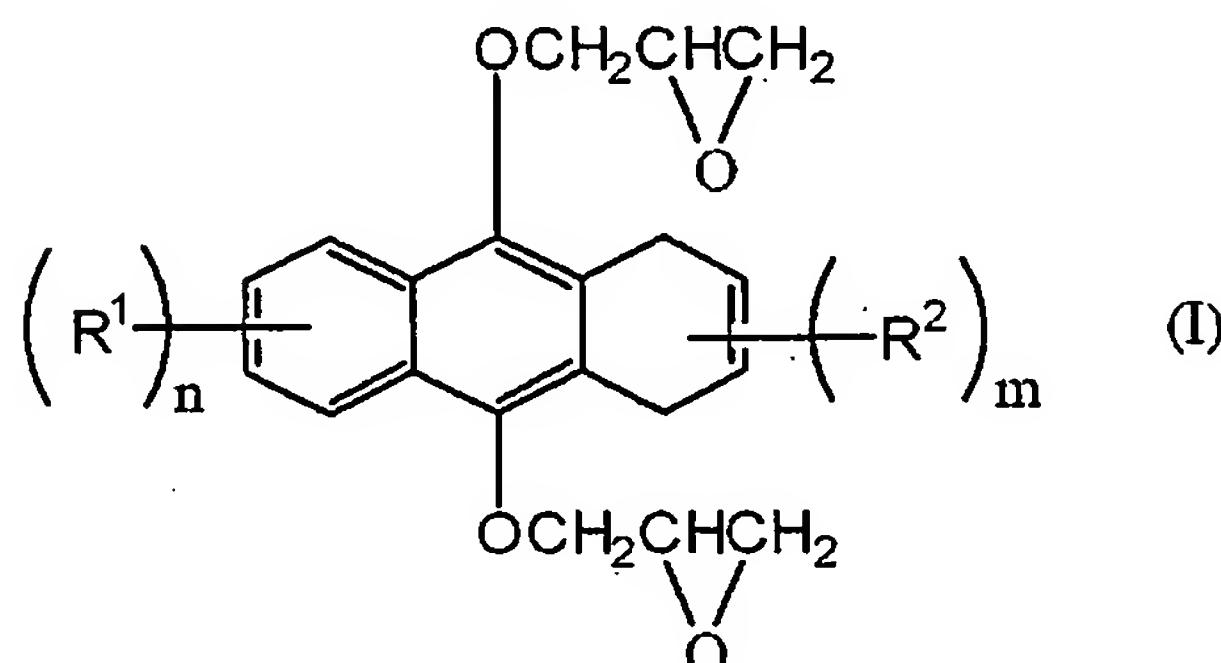
【発明を実施するための最良の形態】

【0011】

本発明において用いられる (A) エポキシ樹脂は、下記一般式 (I) で示される化合物を含有することを特徴とする。

【0012】

【化4】



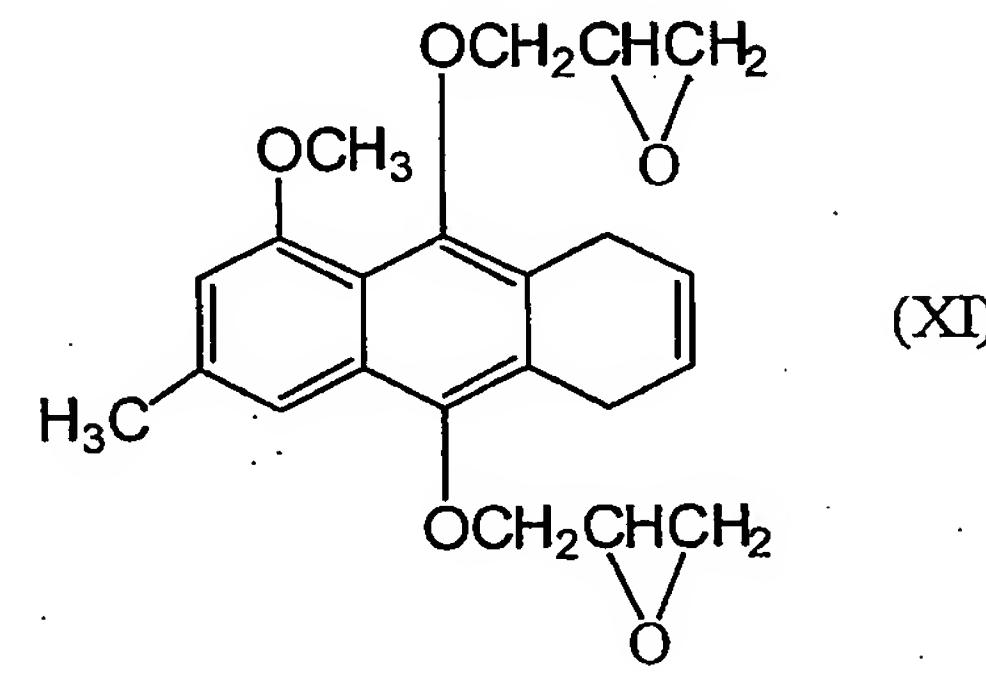
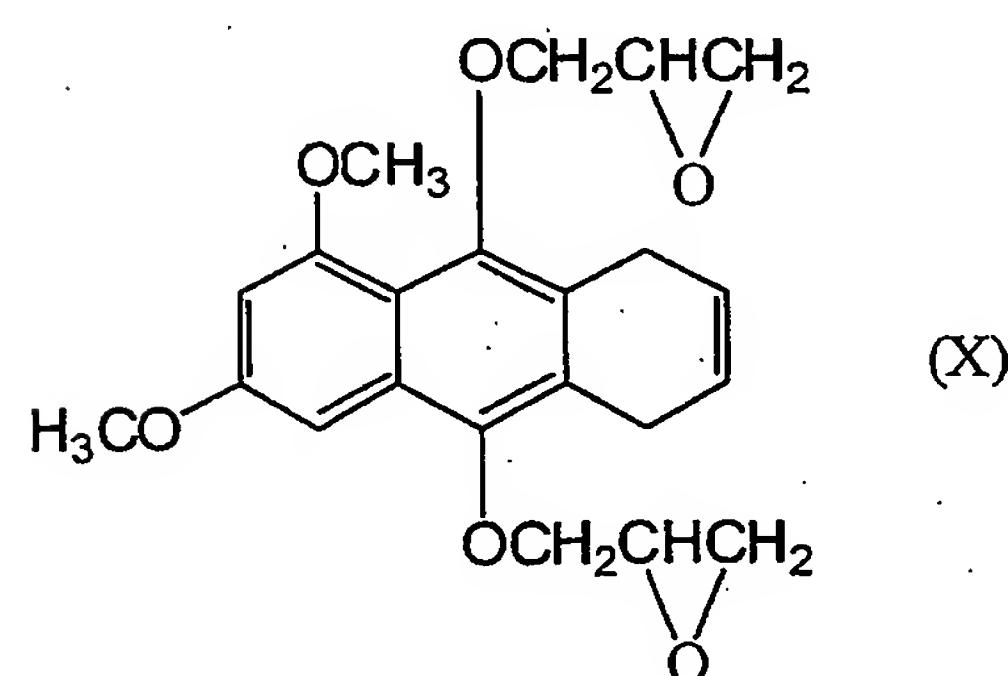
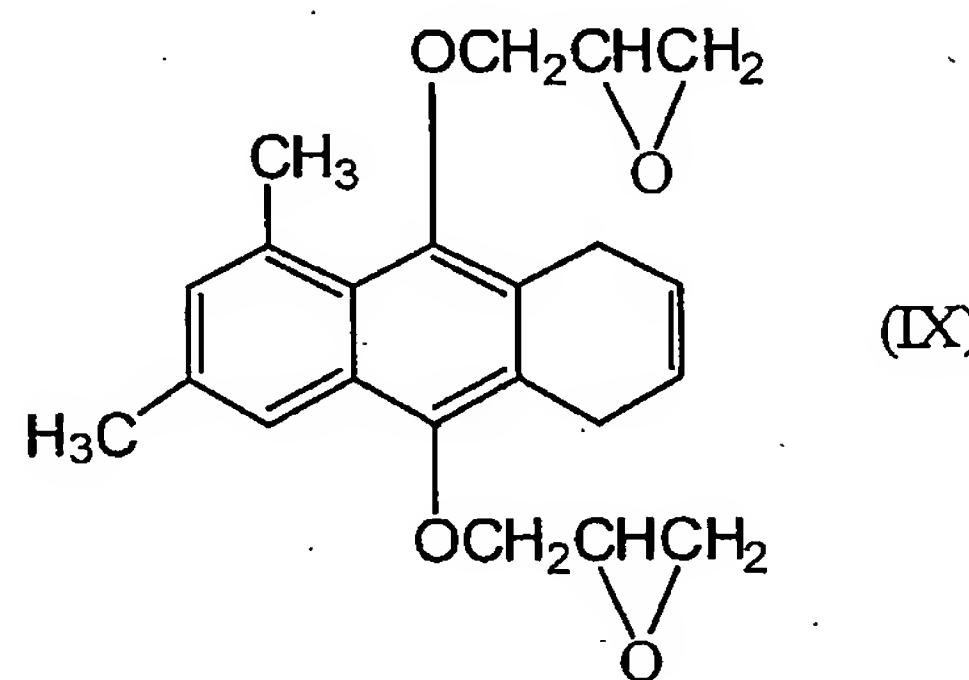
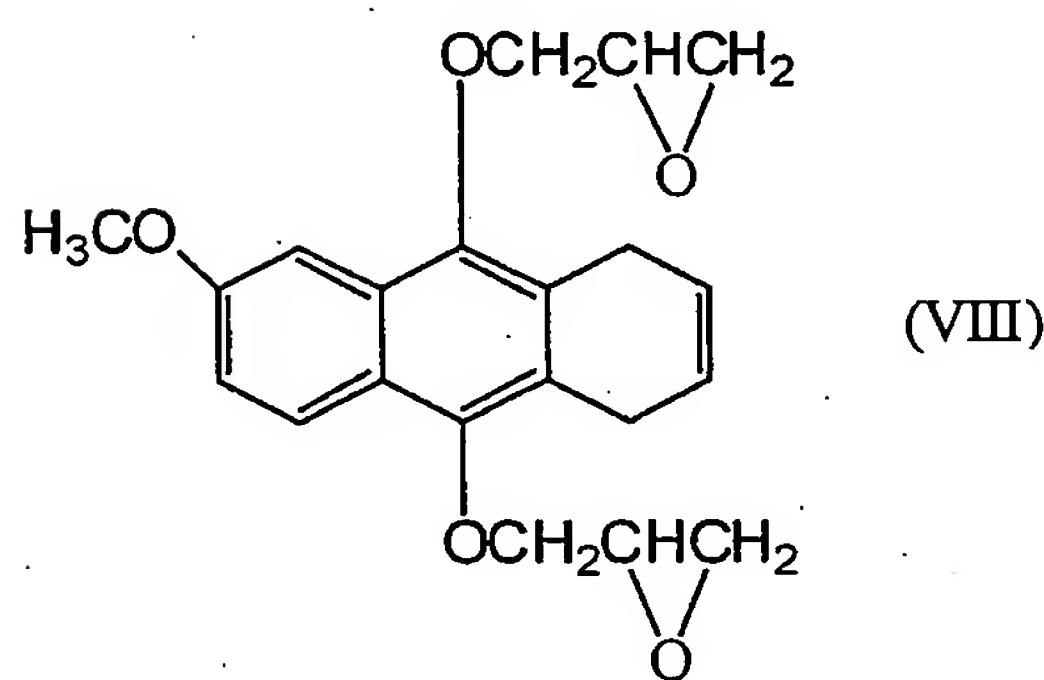
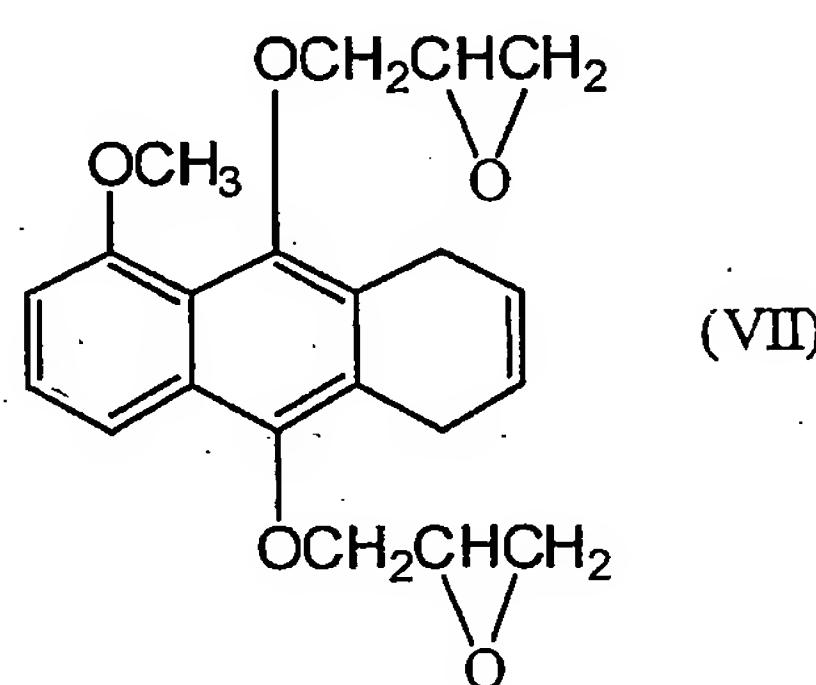
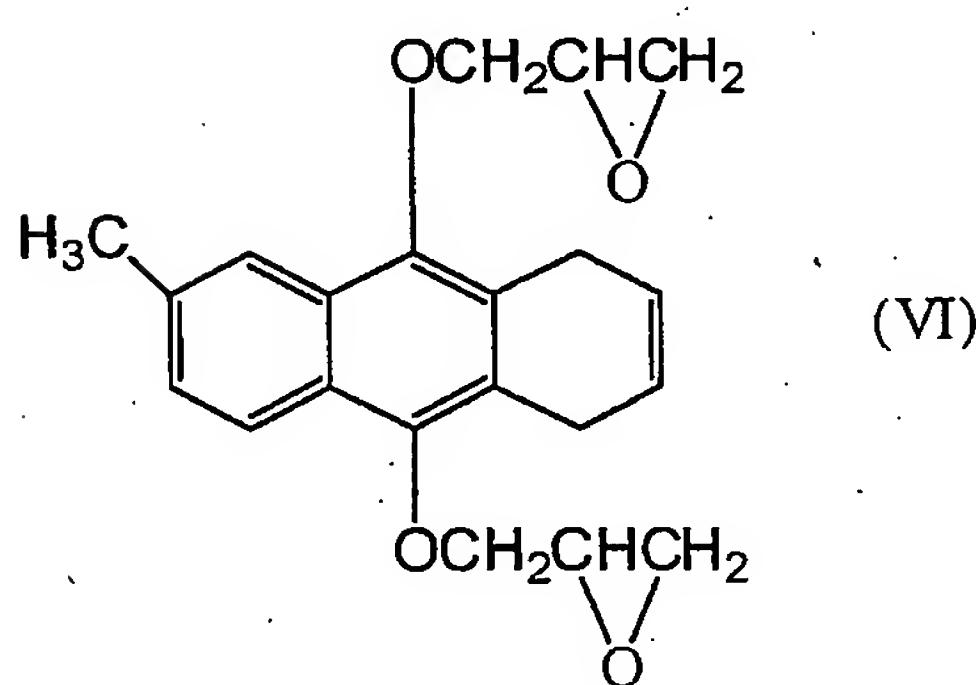
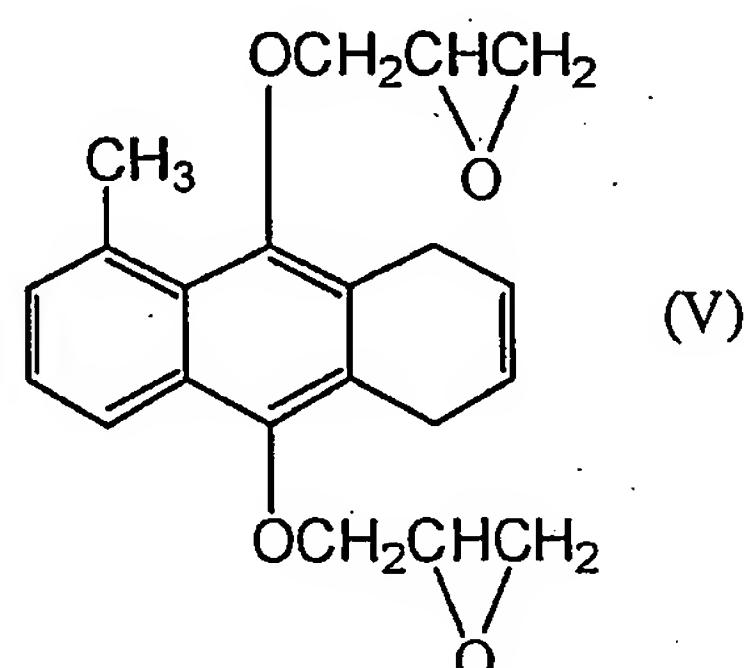
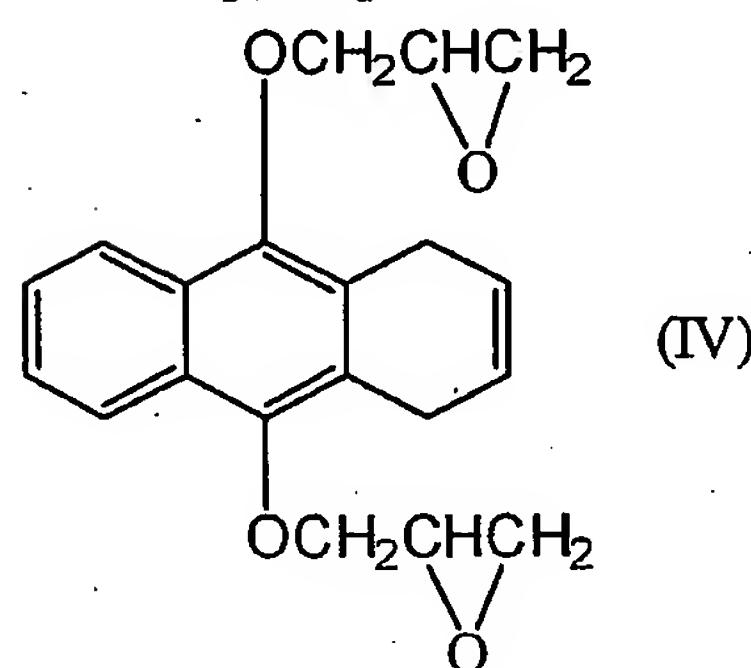
(一般式 (I) 中の  $R^1$  は、置換又は非置換の炭素数 1 ~ 12 の炭化水素基及び置換又は非置換の炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基から選ばれ、全てが同一でも異なっていてもよい。 $n$  は 0 ~ 4 の整数を示す。また  $R^2$  は、置換又は非置換の炭素数 1 ~ 12 の炭化水素基

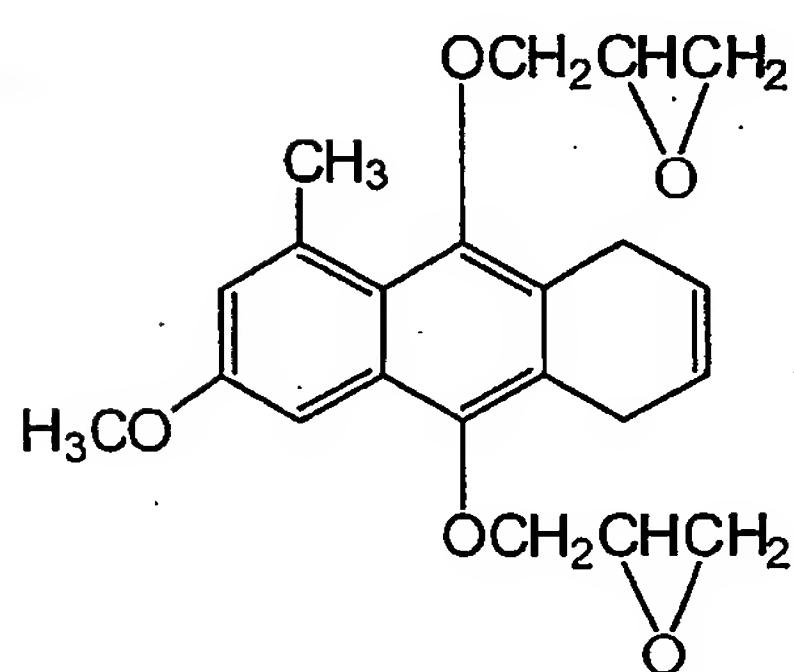
及び置換又は非置換の炭素数1～12のアルコキシ基から選ばれ、全てが同一でも異なつてもよい。mは0～6の整数を示す。)

上記一般式(I)で示されるエポキシ樹脂としては、たとえば下記一般式(IV)～(XI)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられる。

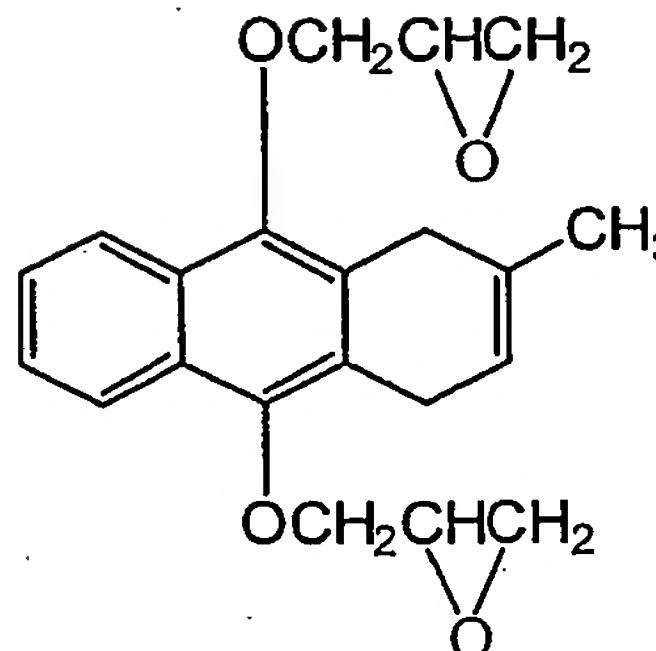
【0013】

【化5】

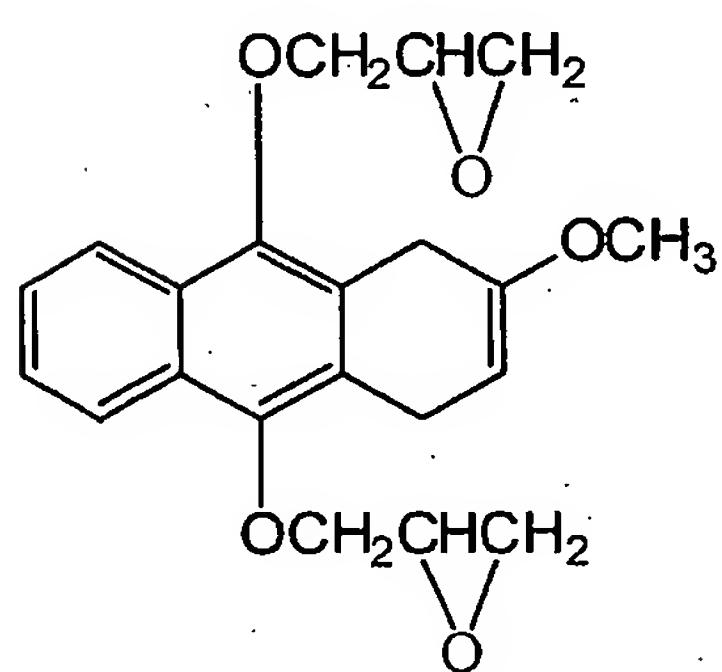




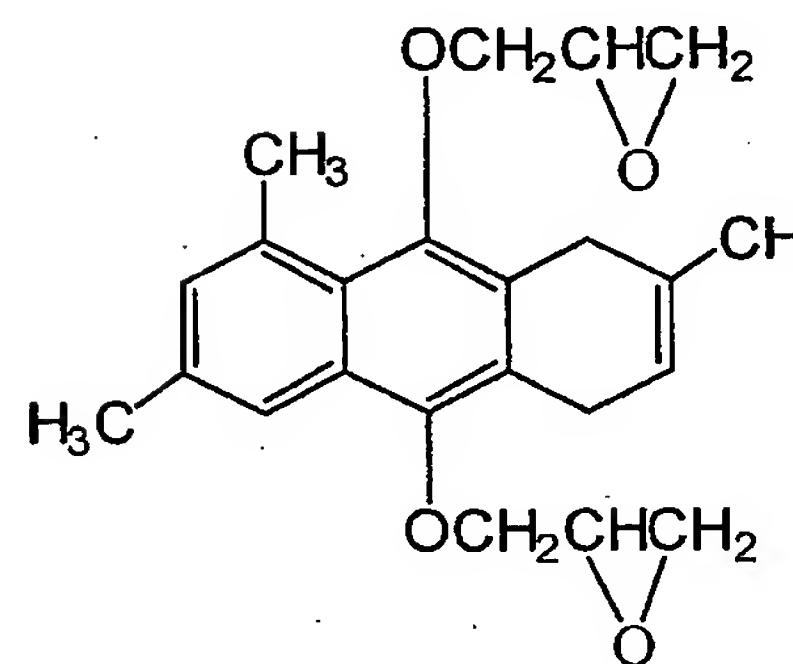
(XII)



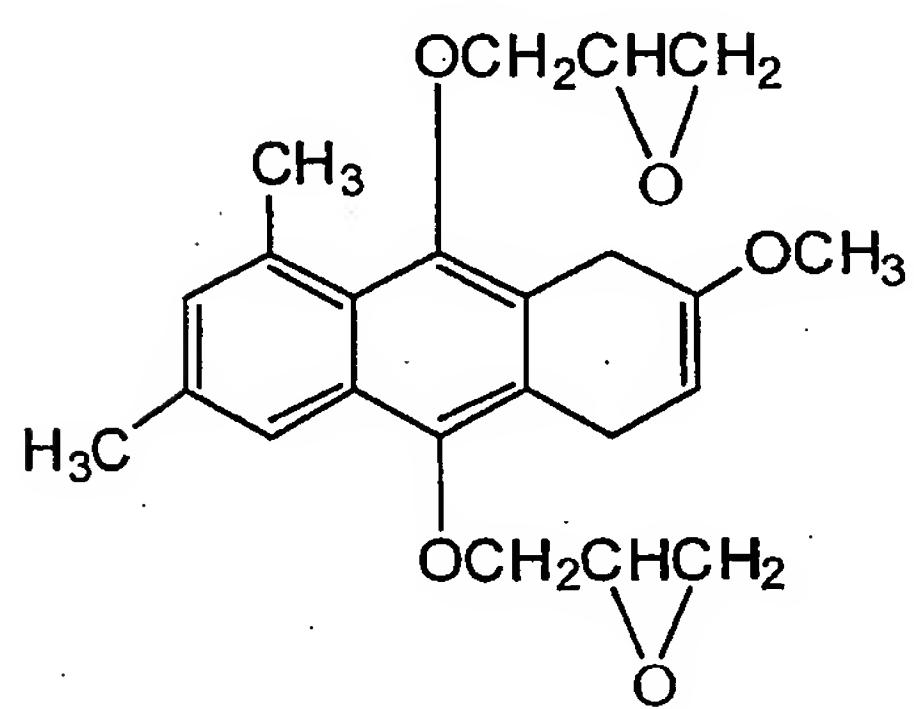
(XIII)



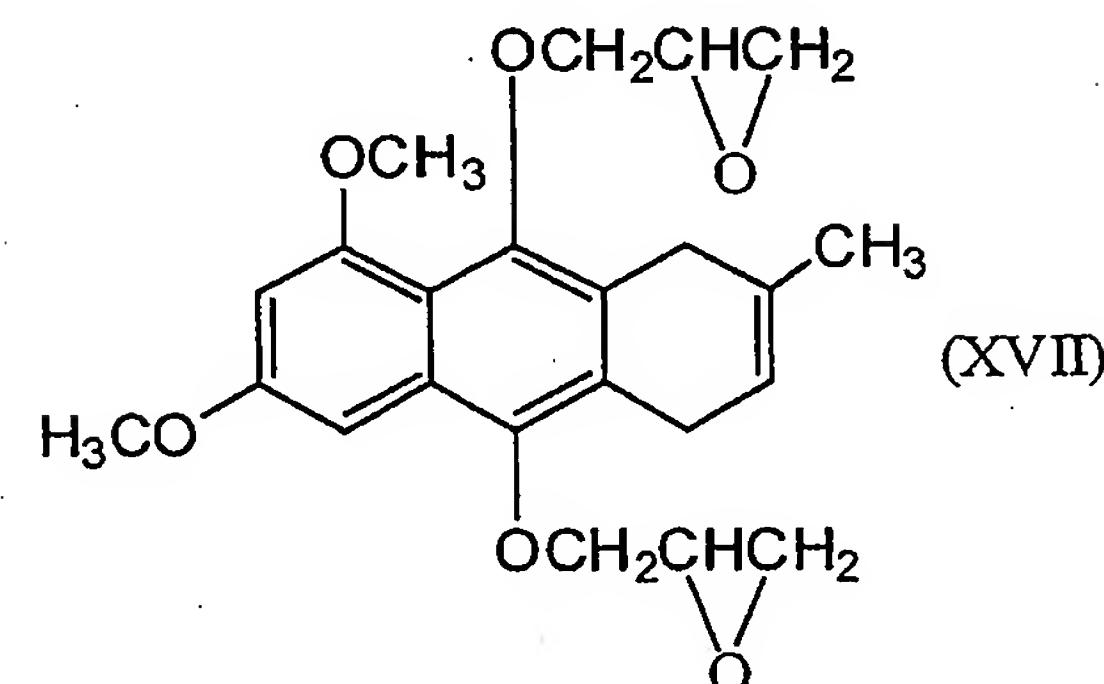
(XIV)



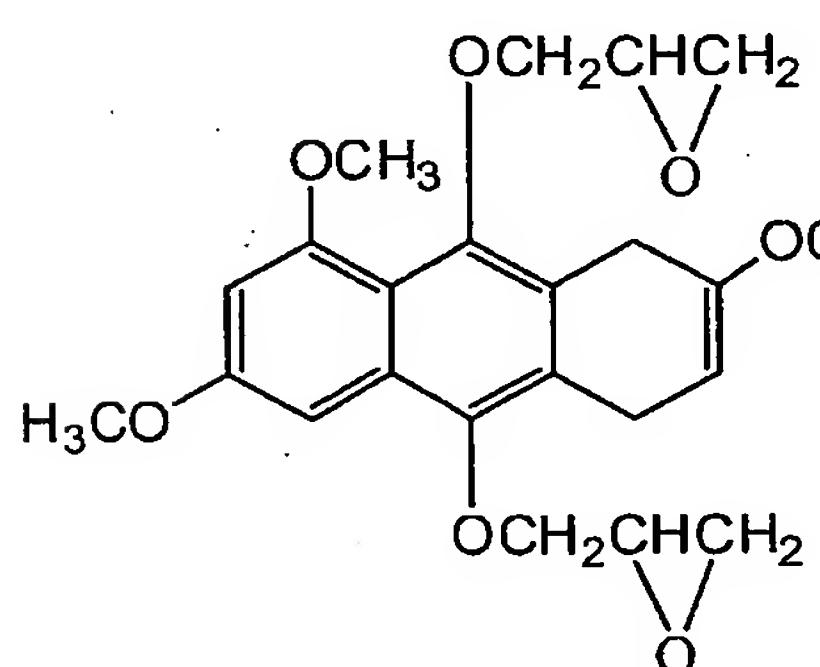
(XV)



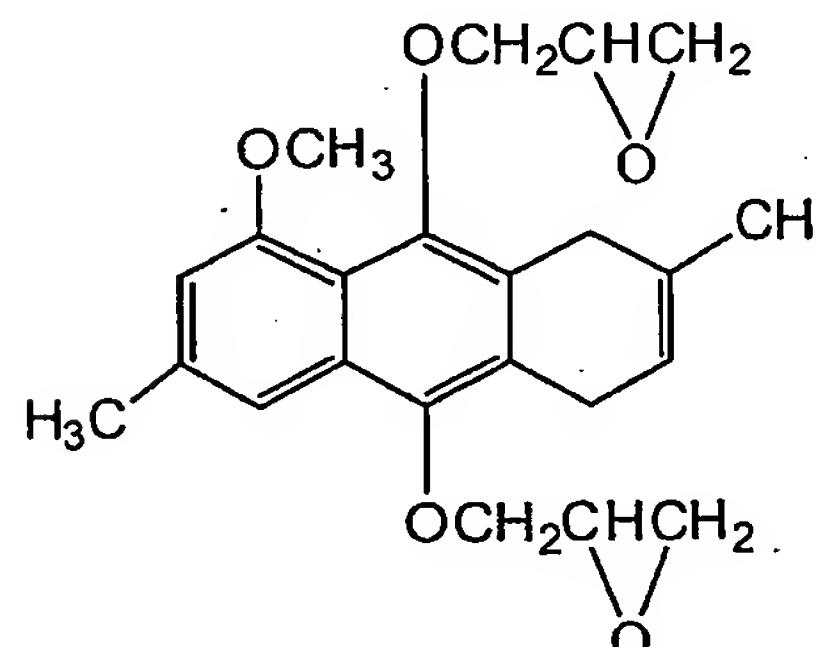
(XVI)



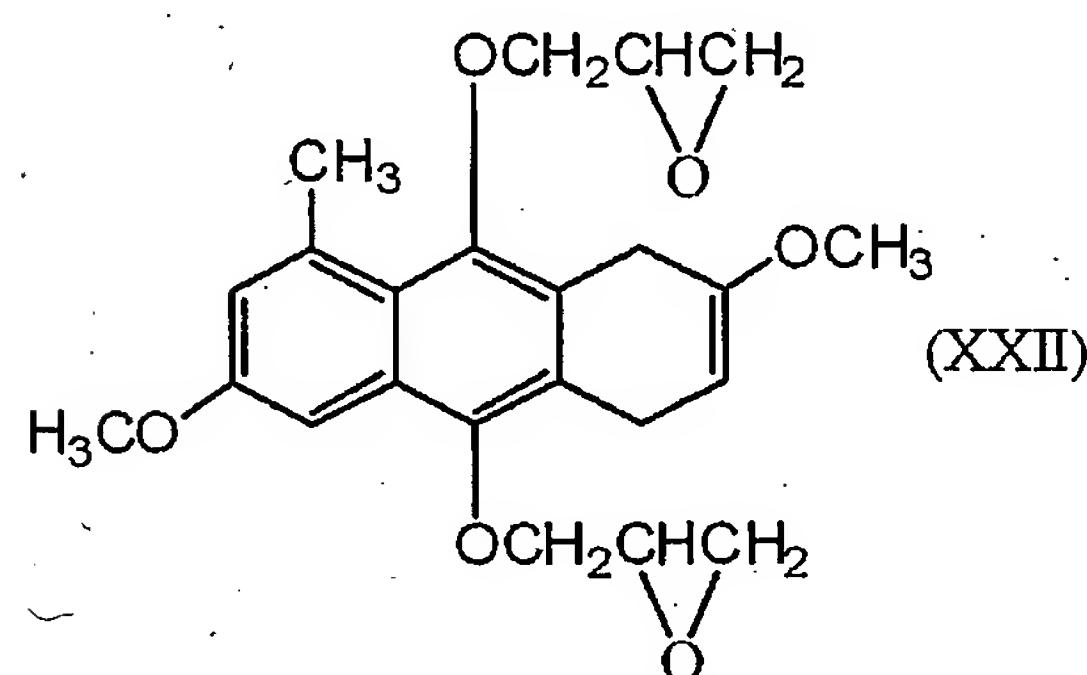
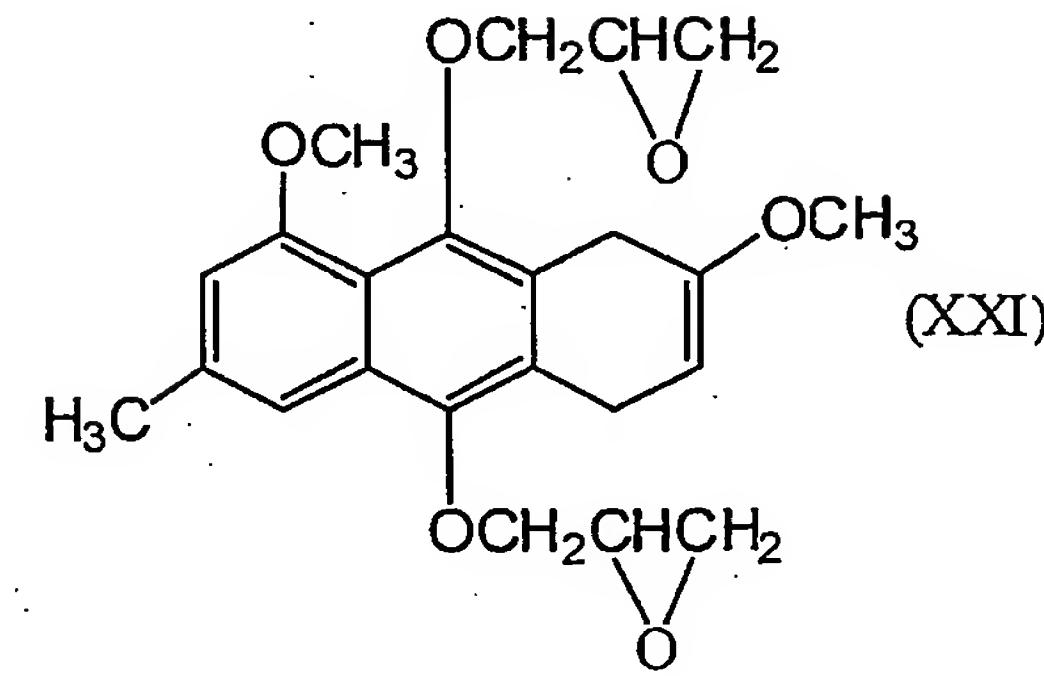
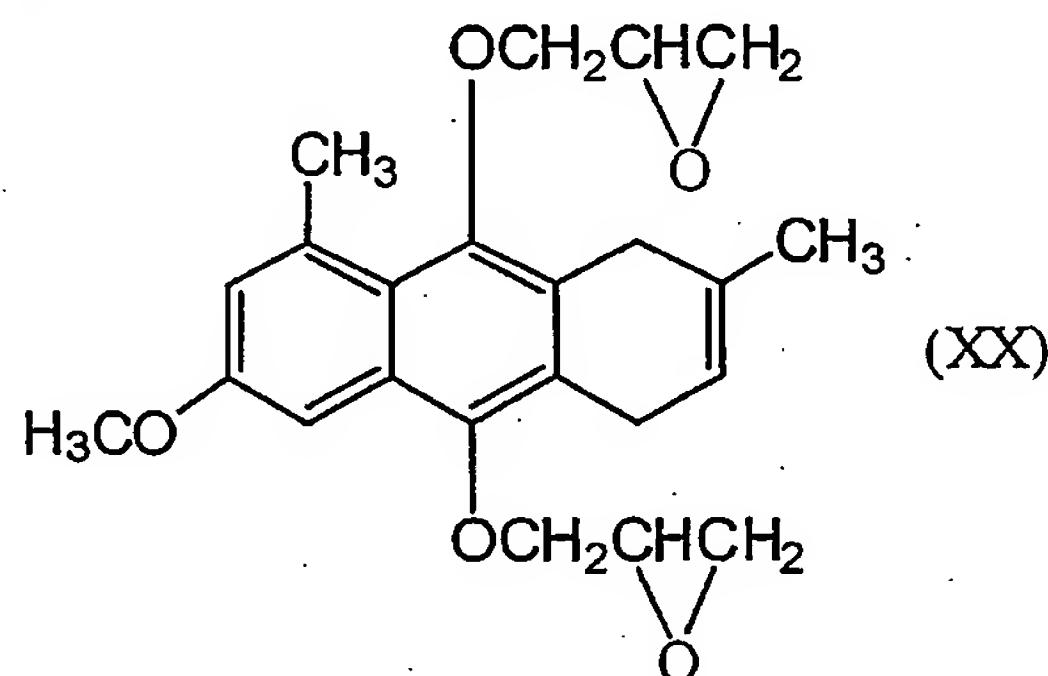
(XVII)



(XVIII)



(XIX)



なかでも、難燃性、成形性の観点からは上記一般式 (IV) で示されるエポキシ樹脂が好ましい。このような化合物としてはYL-7172(ジャパンエポキシレジン社製商品名)等が入手可能である。

上記一般式 (I) で示されるエポキシ樹脂の配合量は、その性能を発揮するためにエポキシ樹脂全量に対して30質量%以上とすることが好ましく、50質量%以上がより好ましく、60質量%以上とすることがさらに好ましい。

#### 【0014】

本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料には、さらに従来公知のエポキシ樹脂を必要に応じて併用することができる。併用可能なエポキシ樹脂としては、たとえば、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂、トリフェニルメタン骨格を有するエポキシ樹脂をはじめとするフェノール、クレゾール、キシレノール、レゾルシン、カテコール、ビスフェノールA、ビスフェノールF等のフェノール類及び/又は $\alpha$ -ナフトール、 $\beta$ -ナフトール、ジヒドロキシナフタレン等のナフトール類とホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ベンズアルデヒド、サリチルアルデヒド等のアルデヒド基を有する化合物とを酸性触媒下で縮合又は共縮合させて得られるノボラック樹脂をエポキシ化したもの。ビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノールS、アルキル置換又は非置換のビフェノール等のジグリシジルエーテル。スチルベン型エポキシ樹脂、ハイドロキノン型エポキシ樹脂、フタル酸、ダイマー酸等の多塩基酸とエピクロルヒドリンの反応により得られるグリシジルエステル型エポキシ樹脂、ジアミノジフェニルメタン、イソシアヌル酸等のポリアミンとエピクロルヒドリンの反応により得られるグリシジルアミン型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエンとフェノール類の共縮合樹脂のエポキシ化物、ナフタレン環を有するエポキシ樹脂、キシリレン骨格、ビフェニレン骨格を含有するフェノール・アラルキル樹脂、ナフトール・アラルキル樹脂等のアラルキル型フェノール樹脂のエポキシ化物、トリメチロールプロパン型エポキシ樹脂、テルペン変性エポキシ樹脂、オレフィン結合を過酢酸等の過酸で酸化して得られる線状脂肪族エポキシ樹脂、脂環族エポキシ樹脂、硫黄原子含有エポキシ樹脂などが挙げられ、これらを単独で用いても2種以上を組み合わせて併用して用いてもよい。

#### 【0015】

なかでも、流動性及び耐リフロー性の観点からはビフェニル型エポキシ樹脂、ビスフェ

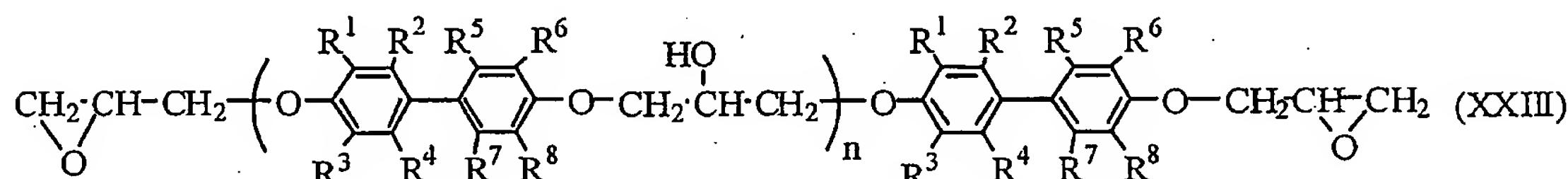
ノールF型エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂及び硫黄原子含有エポキシ樹脂が好ましく、硬化性の観点からはノボラック型エポキシ樹脂が好ましく、低吸湿性の観点からはジシクロペニタジエン型エポキシ樹脂が好ましく、耐熱性及び低反り性の観点からはナフタレン型エポキシ樹脂及びトリフェニルメタン型エポキシ樹脂が好ましく、これらのエポキシ樹脂の少なくとも1種を含有して併用していることが好ましい。

## 【0016】

ビフェニル型エポキシ樹脂としてはたとえば下記一般式(XXIII)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられ、ビスフェノールF型エポキシ樹脂としてはたとえば下記一般式(XXIV)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられ、スチルベン型エポキシ樹脂としてはたとえば下記一般式(XXV)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられ、硫黄原子含有エポキシ樹脂としてはたとえば下記一般式(XXVI)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられる。

## 【0017】

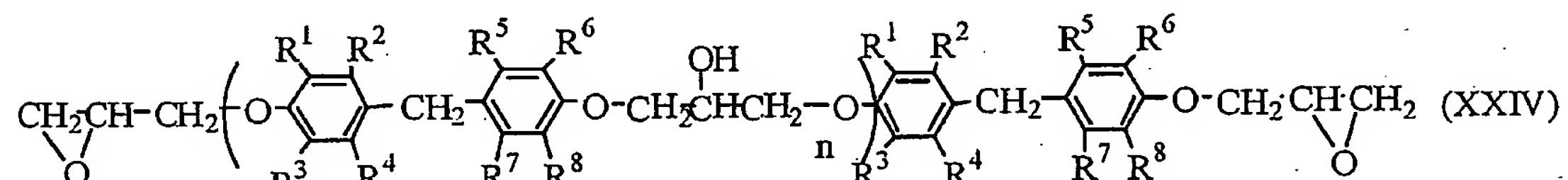
## 【化6】



(ここで、R<sup>1</sup>～R<sup>8</sup>は水素原子及び炭素数1～10の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、全てが同一でも異なっていてもよい。nは0～3の整数を示す。)

## 【0018】

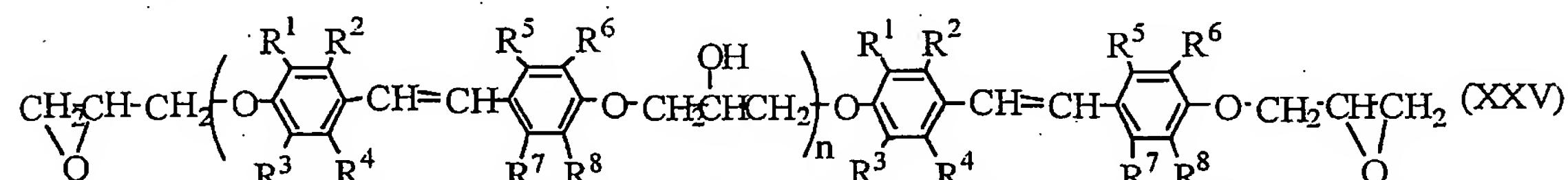
## 【化7】



(ここで、R<sup>1</sup>～R<sup>8</sup>は水素原子、炭素数1～10のアルキル基、炭素数1～10のアルコキシル基、炭素数6～10のアリール基、及び炭素数6～10のアラルキル基から選ばれ、全てが同一でも異なっていてもよい。nは0～3の整数を示す。)

## 【0019】

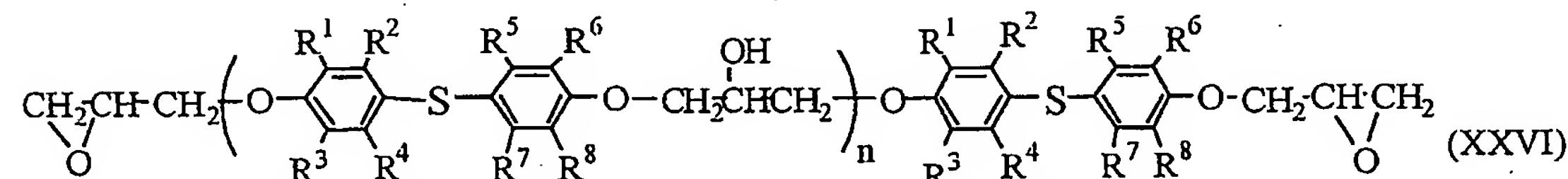
## 【化8】



(ここで、R<sup>1</sup>～R<sup>8</sup>は水素原子及び炭素数1～5の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、全てが同一でも異なっていてもよい。nは0～10の整数を示す。)

## 【0020】

## 【化9】



(ここで、R<sup>1</sup>～R<sup>8</sup>は水素原子、置換又は非置換の炭素数1～10のアルキル基及び置換又は非置換の炭素数1～10のアルコキシ基から選ばれ、全てが同一でも異なっていてもよい。nは0～3の整数を示す。)

## 【0021】

上記一般式(XXIII)で示されるビフェニル型エポキシ樹脂としては、たとえば、4,4'-ビス(2,3-エポキシプロポキシ)ビフェニル又は4,4'-ビス(2,3-エポキシプロポキシ)-3,3',5,5'-テトラメチルビフェニルを主成分とする

エポキシ樹脂、エピクロルヒドリンと4, 4'-ビフェノール又は4, 4'-(3, 3', 5, 5'-テトラメチル)ビフェノールとを反応させて得られるエポキシ樹脂等が挙げられる。なかでも4, 4'-ビス(2, 3-エポキシプロポキシ)-3, 3', 5, 5'-テトラメチルビフェニルを主成分とするエポキシ樹脂が好ましい。このような化合物としてはYX-4000(ジャパンエポキシレジン株式会社製商品名)等が市販品として入手可能である。

#### 【0022】

上記一般式(XXIV)で示されるビスフェノールF型エポキシ樹脂としては、例えば、R<sup>1</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>6</sup>及びR<sup>8</sup>がメチル基で、R<sup>2</sup>、R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>及びR<sup>7</sup>が水素原子であり、n=0を主成分とするYSLV-80XY(東都化成株式会社製商品名)等が市販品として入手可能である。

#### 【0023】

上記一般式(XXV)で示されるスチルベン型エポキシ樹脂は、原料であるスチルベン系フェノール類とエピクロルヒドリンとを塩基性物質存在下で反応させて得ることができる。この原料であるスチルベン系フェノール類としては、たとえば3-tert-ブチル-4, 4'-ジヒドロキシ-3', 5, 5'-トリメチルスチルベン、3-tert-ブチル-4, 4'-ジヒドロキシ-3', 5', 6-トリメチルスチルベン、4, 4'-ジヒドロキシ-3, 3', 5, 5'-テトラメチルスチルベン、4, 4'-ジヒドロキシ-3, 3'-ジ-tert-ブチル-5, 5'-ジメチルスチルベン、4, 4'-ジヒドロキシ-3, 3'-ジ-tert-ブチル-6, 6'-ジメチルスチルベン等が挙げられ、なかでも3-tert-ブチル-4, 4'-ジヒドロキシ-3', 5, 5'-トリメチルスチルベン、及び4, 4'-ジヒドロキシ-3, 3', 5, 5'-テトラメチルスチルベンが好ましい。これらのスチルベン型フェノール類は単独で用いても2種以上を組み合わせて用いてもよい。

#### 【0024】

上記一般式(XXVI)で示される硫黄原子含有エポキシ樹脂のなかでも、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>6</sup>及びR<sup>7</sup>が水素原子で、R<sup>1</sup>、R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>及びR<sup>8</sup>がアルキル基であるエポキシ樹脂が好ましく、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>6</sup>及びR<sup>7</sup>が水素原子で、R<sup>1</sup>及びR<sup>8</sup>がtert-ブチル基で、R<sup>4</sup>及びR<sup>5</sup>がメチル基であるエポキシ樹脂がより好ましい。このような化合物としては、YSLV-120TE(東都化成株式会社製商品名)等が市販品として入手可能である。

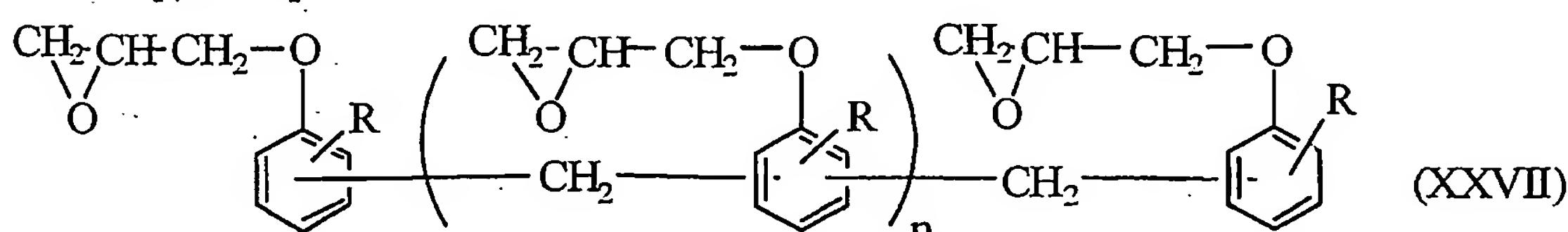
これらのエポキシ樹脂はいずれか1種を単独で併用に用いても2種以上を組合させて併用に用いてもよい。

#### 【0025】

ノボラック型エポキシ樹脂としては、たとえば下記一般式(XXVII)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられる。

#### 【0026】

#### 【化10】



(ここで、Rは水素原子及び炭素数1~10の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、nは0~10の整数を示す。)

上記一般式(XXVII)で示されるノボラック型エポキシ樹脂は、ノボラック型フェノール樹脂にエピクロルヒドリンを反応させることによって容易に得られる。なかでも、一般式(XXVII)中のRとしては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、イソブチル基等の炭素数1~10のアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~10のアルコキシル基が好ましく、水素原子

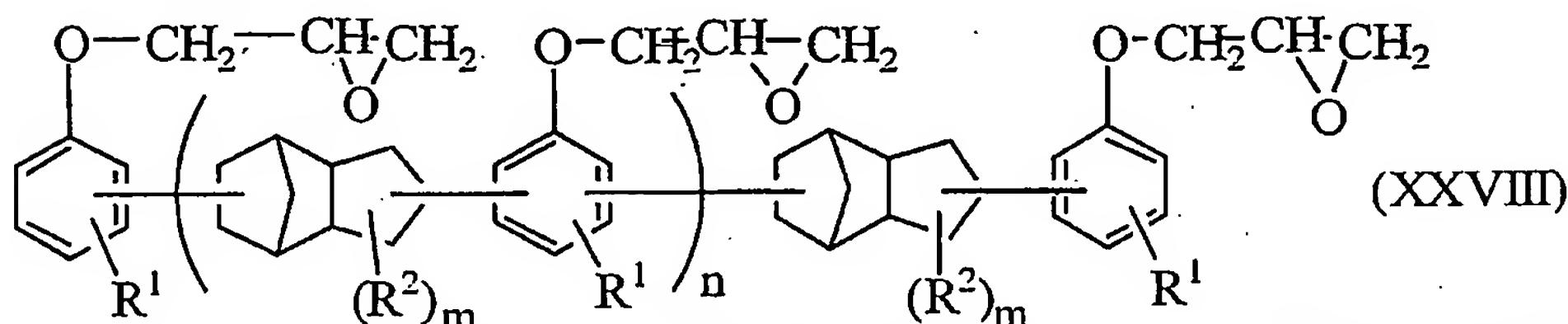
又はメチル基がより好ましい。nは0～3の整数が好ましい。上記一般式（XXVII）で示されるノボラック型エポキシ樹脂のなかでも、オルトクレゾールノボラック型エポキシ樹脂が好ましい。このような化合物としてはESCN-190（住友化学株式会社製商品名）等が市販品として入手可能である。

[0027]

ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂としては、たとえば下記一般式（X X V I I I ）で示されるエポキシ樹脂等が挙げられる。

[0 0 2 8]

〔化 1 1〕



(ここで、 $R^1$  及び  $R^2$  は水素原子及び炭素数 1 ~ 10 の置換又は非置換の一価の炭化水素基からそれぞれ独立して選ばれ、 $n$  は 0 ~ 10 の整数を示し、 $m$  は 0 ~ 6 の整数を示す。)

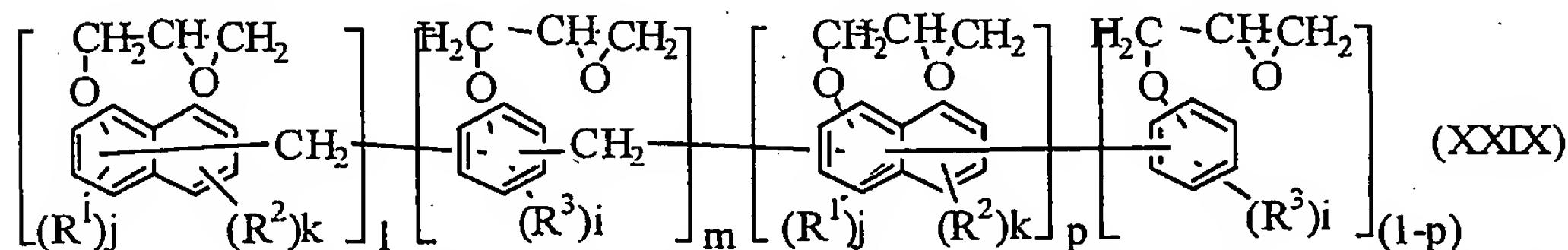
上記式 (X X V I I I) 中の  $R^1$  としては、たとえば、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、*tert*-ブチル基等のアルキル基、ビニル基、アリル基、ブテニル基等のアルケニル基、ハロゲン化アルキル基、アミノ基置換アルキル基、メルカプト基置換アルキル基などの炭素数 1 ~ 5 の置換又は非置換の一価の炭化水素基が挙げられ、なかでもメチル基、エチル基等のアルキル基及び水素原子が好ましく、メチル基及び水素原子がより好ましい。 $R^2$  としては、たとえば、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、*tert*-ブチル基等のアルキル基、ビニル基、アリル基、ブテニル基等のアルケニル基、ハロゲン化アルキル基、アミノ基置換アルキル基、メルカプト基置換アルキル基などの炭素数 1 ~ 5 の置換又は非置換の一価の炭化水素基が挙げられ、なかでも水素原子が好ましい。このような化合物としては H P - 7 2 0 0 (大日本インキ化学工業株式会社製商品名) 等が市販品として入手可能である。

[0 0 2 9]

ナフタレン型エポキシ樹脂としてはたとえば下記一般式（XXXIX）で示されるエポキシ樹脂等が挙げられ、トリフェニルメタン型エポキシ樹脂としてはたとえば下記一般式（XXX）で示されるエポキシ樹脂等が挙げられる。

[0 0 3 0]

[化 1 2]



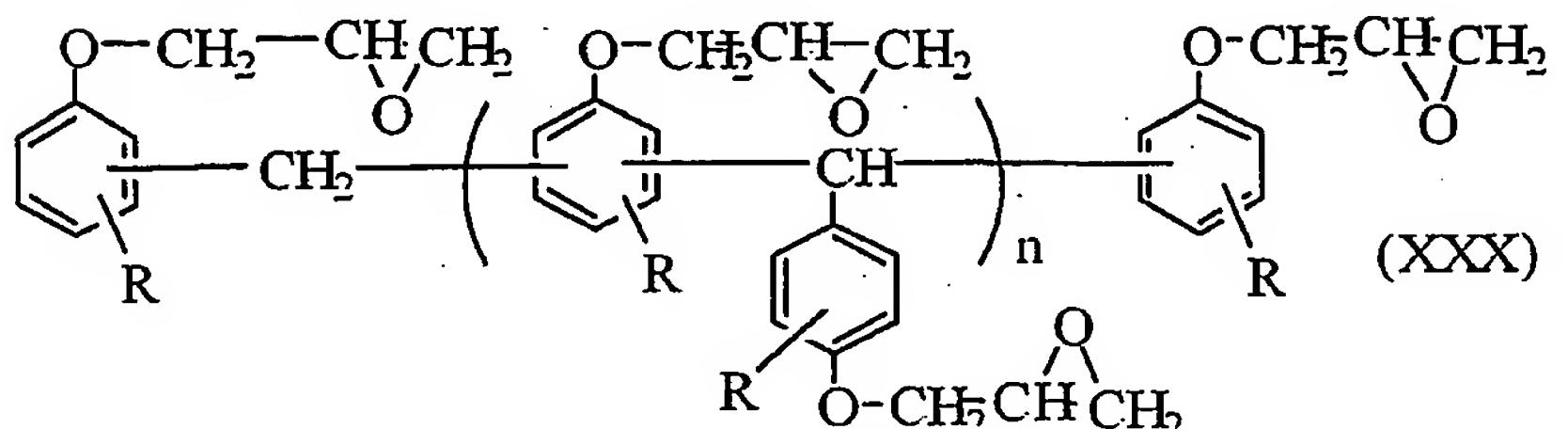
(ここで、 $R^1 \sim R^3$  は水素原子及び置換又は非置換の炭素数 1 ~ 12 の一価の炭化水素基から選ばれ、それぞれ全てが同一でも異なっていてもよい。p は 1 又は 0 で、l, m はそれぞれ 0 ~ 11 の整数であって、 $(l+m)$  が 1 ~ 11 の整数でかつ  $(l+p)$  が 1 ~ 12 の整数となるよう選ばれる。i は 0 ~ 3 の整数、j は 0 ~ 2 の整数、k は 0 ~ 4 の整数を示す。)

上記一般式 (XXXIX) で示されるナフタレン型エポキシ樹脂としては、1個の構成単位及びm個の構成単位をランダムに含むランダム共重合体、交互に含む交互共重合体、規則的に含む共重合体、ブロック状に含むブロック共重合体が挙げられ、これらのいずれか1種を単独で用いても、2種以上を組み合わせて用いてもよい。R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>が水素原子で

、R<sup>3</sup> がメチル基である上記化合物としては、NC-7000（日本化薬株式会社製商品名）等が市販品として入手可能である。

【0031】

【化13】



（ここで、Rは水素原子及び炭素数1～10の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、nは1～10の整数を示す。）

Rが水素原子である上記化合物としてはE-1032（ジャパンエポキシレジン株式会社製商品名）等が市販品として入手可能である。

これらのエポキシ樹脂はいずれか1種を単独で用いても両者を組合わせて用いてもよい。

【0032】

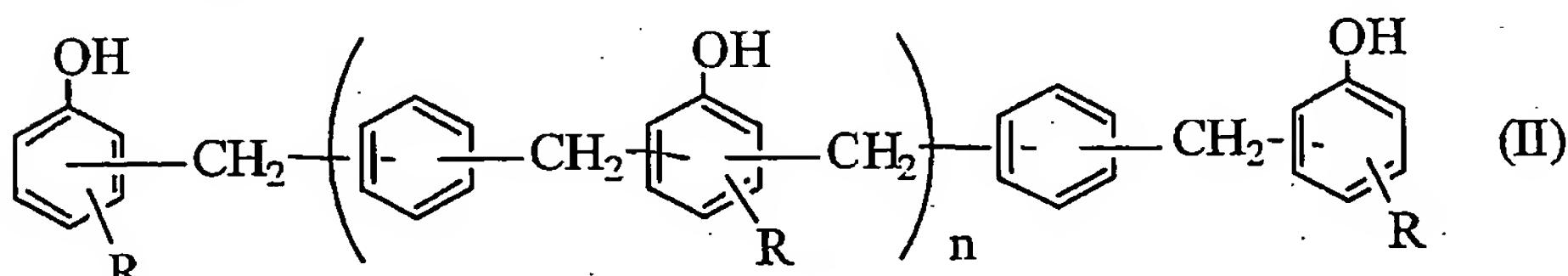
本発明において用いられる（B）硬化剤は、封止用エポキシ樹脂成形材料に一般に使用されているもので特に制限はないが、たとえば、フェノール、クレゾール、レゾルシン、カテコール、ビスフェノールA、ビスフェノールF、フェニルフェノール、アミノフェノール等のフェノール類及び／又はα-ナフトール、β-ナフトール、ジヒドロキシナフタレン等のナフトール類とホルムアルデヒド、ベンズアルデヒド、サリチルアルデヒド等のアルデヒド基を有する化合物とを酸性触媒下で縮合又は共縮合させて得られるノボラック型フェノール樹脂、フェノール類及び／又はナフトール類とジメトキシパラキシレン又はビス（メトキシメチル）ビフェニルから合成されるフェノール・アラルキル樹脂、ビフェニレン型フェノール・アラルキル樹脂、ナフトール・アラルキル樹脂等のアラルキル型フェノール樹脂、フェノール類及び／又はナフトール類とジシクロペニタジエンから共重合により合成される、ジシクロペニタジエン型フェノールノボラック樹脂、ジシクロペニタジエン型ナフトールノボラック樹脂等のジシクロペニタジエン型フェノール樹脂、トリフェニルメタン型フェノール樹脂、テルペン変性フェノール樹脂、パラキシリレン及び／又はメタキシリレン変性フェノール樹脂、メラミン変性フェノール樹脂、シクロペニタジエン変性フェノール樹脂、これら2種以上を共重合して得たフェノール樹脂などが挙げられる。これらを単独で用いても2種以上を組み合せて用いてもよい。

【0033】

なかでも、難燃性、成形性の観点からは下記一般式（II）で示されるフェノール・アラルキル樹脂であることが好ましい。

【0034】

【化14】



（ここで、Rは水素原子及び炭素数1～10の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、nは0～10の整数を示す。）

一般式（II）中のRが水素原子で、nの平均値が0～8であるフェノール・アラルキル樹脂がより好ましい。具体例としては、p-キシリレン型フェノール・アラルキル樹脂、m-キシリレン型フェノール・アラルキル樹脂等が挙げられる。このような化合物としてはXLC（三井化学株式会社製商品名）等が市販品として入手可能である。これらのア

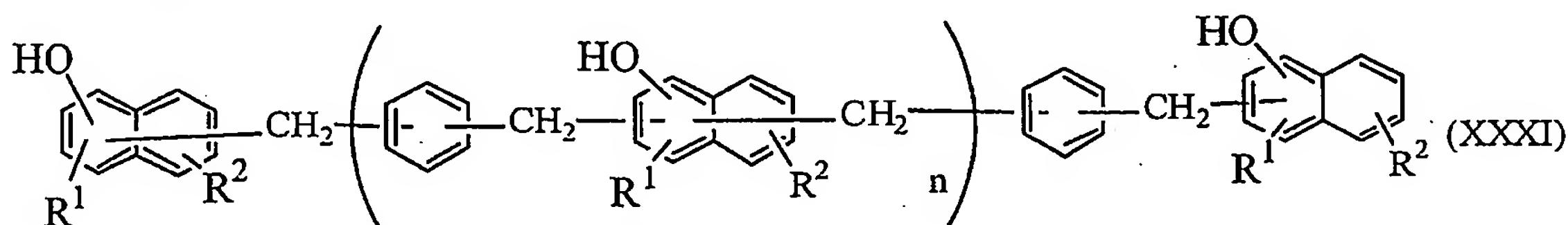
ラルキル型フェノール樹脂を用いる場合、その配合量は、その性能を発揮するために硬化剤全量に対して30質量%以上とすることが好ましく、50質量%以上がより好ましい。

## 【0035】

ナフトール・アラルキル樹脂としては、たとえば下記一般式(XXXI)で示されるフェノール樹脂等が挙げられる。

## 【0036】

## 【化15】



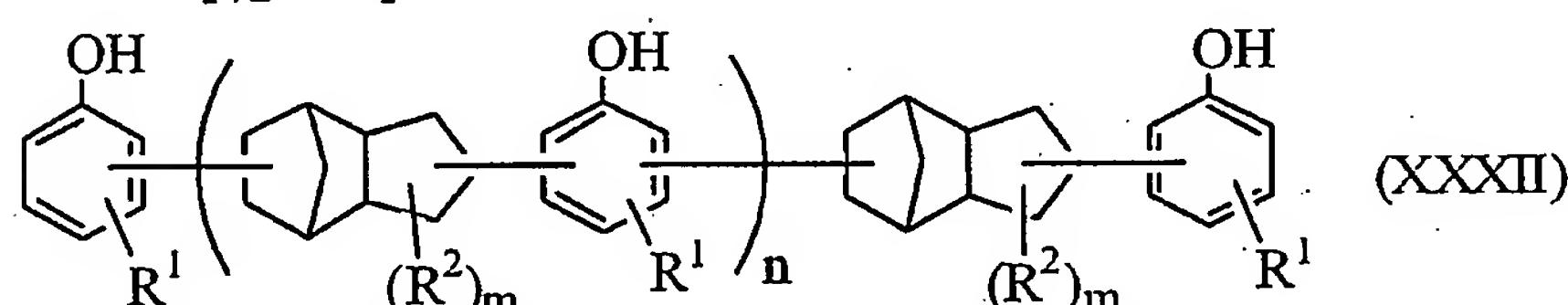
上記一般式(XXXI)で示されるナフトール・アラルキル樹脂としては、たとえばR<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>が全て水素原子である化合物等が挙げられ、このような化合物としては、SN-170(新日鐵化学株式会社製商品名)が市販品として入手可能である。

## 【0037】

ジシクロペントジエン型フェノール樹脂としては、たとえば下記一般式(XXXII)で示されるフェノール樹脂等が挙げられる。

## 【0038】

## 【化16】



(ここで、R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は水素原子及び炭素数1～10の置換又は非置換の一価の炭化水素基からそれぞれ独立して選ばれ、nは0～10の整数を示し、mは0～6の整数を示す。)

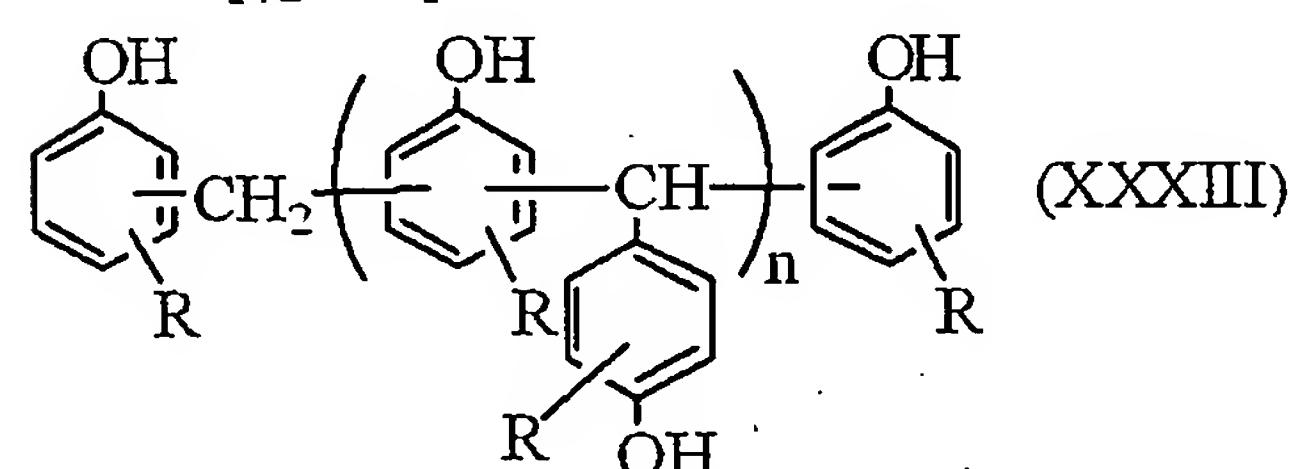
R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>が水素原子である上記化合物としてはDPP(新日本石油化学株式会社製商品名)等が市販品として入手可能である。

## 【0039】

トリフェニルメタン型フェノール樹脂としては、たとえば下記一般式(XXXIII)で示されるフェノール樹脂等が挙げられる。

## 【0040】

## 【化17】



(ここで、Rは水素原子及び炭素数1～10の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、nは1～10の整数を示す。)

Rが水素原子である上記化合物としては、MEH-7500(明和化成株式会社製商品名)等が市販品として入手可能である。

## 【0041】

ノボラック型フェノール樹脂としては、たとえばフェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、ナフトールノボラック樹脂等が挙げられ、なかでもフェノールノボラック樹脂が好ましい。

## 【0042】

上記のアラルキル型フェノール樹脂、ナフトール・アラルキル樹脂、ジシクロペニタジエン型フェノール樹脂、トリフェニルメタン型フェノール樹脂及びノボラック型フェノール樹脂は、いずれか1種を単独で用いても2種以上を組合わせて用いてもよい。

## 【0043】

本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料には難燃性を向上させる観点から、アセナフチレンを含有してもよい。アセナフチレンはアセナフテンを脱水素して得ることができるが、市販品を用いてもよい。また、アセナフチレンの重合物又はアセナフチレンと他の芳香族オレフィンとの重合物として用いることもできる。アセナフチレンの重合物又はアセナフチレンと他の芳香族オレフィンとの重合物を得る方法としては、ラジカル重合、カチオン重合、アニオン重合等が挙げられる。また、重合に際しては従来公知の触媒を用いることができるが、触媒を用いずに熱だけで行うこともできる。この際、重合温度は80～160℃が好ましく、90～150℃がより好ましい。得られるアセナフチレンの重合物又はアセナフチレンと他の芳香族オレフィンとの重合物の軟化点は、60～150℃が好ましく、70～130℃がより好ましい。60℃より低いと成形時の染み出しにより成形性が低下する傾向にあり、150℃より高いと樹脂との相溶性が低下する傾向にある。

## 【0044】

アセナフチレンと共に重合させる他の芳香族オレフィンとしては、スチレン、 $\alpha$ -メチルスチレン、インデン、ベンゾチオフェン、ベンゾフラン、ビニルナフタレン、ビニルビフェニル又はそれらのアルキル置換体等が挙げられる。また、上記した芳香族オレフィン以外に本発明の効果に支障の無い範囲で脂肪族オレフィンを併用することもできる。脂肪族オレフィンとしては、(メタ)アクリル酸及びそれらのエステル、無水マレイン酸、無水イタコン酸、フマル酸及びそれらのエステル等が挙げられる。これら脂肪族オレフィンの使用量は重合モノマー全量に対して20重量%以下が好ましく、9重量%以下がより好ましい。

## 【0045】

さらに、アセナフチレンとして、(B)硬化剤の一部又は全部と予備混合されたアセナフチレンを含有することもできる。(B)硬化剤の一部又は全部と、アセナフチレン、アセナフチレンの重合物及びアセナフチレンと他の芳香族オレフィンとの重合物の1種以上とを予備混合したものを用いてもよい。予備混合の方法としては、(B)及びアセナフチレン成分をそれぞれ微細に粉碎し固体状態のままミキサー等で混合する方法、両成分を溶解する溶媒に均一に溶解させた後溶媒を除去する方法、(B)及び/又はアセナフチレン成分の軟化点以上の温度で両者を溶融混合する方法等で行うことができるが、均一な混合物が得られて不純物の混入が少ない溶融混合法が好ましい。溶融混合は、(B)及び/又はアセナフチレン成分の軟化点以上の温度であれば制限はないが、100～250℃が好ましく、120～200℃がより好ましい。また、溶融混合は両者が均一に混合すれば混合時間に制限はないが、1～20時間が好ましく、2～15時間がより好ましい。

## 【0046】

(B)硬化剤とアセナフチレンを予備混合する場合、混合中にアセナフチレン成分が重合もしくは(B)硬化剤と反応しても構わない。本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料中には、アセナフチレン成分の分散性に起因する難燃性向上の観点から前述の予備混合物(アセナフチレン変性硬化剤)が(B)硬化剤中に90重量%以上含まれることが好ましい。アセナフチレン変性硬化剤中に含まれるアセナフチレン及び/又はアセナフチレンを含む芳香族オレフィンの重合物の量は5～40重量%が好ましく、8～25重量%がより好ましい。5重量%より少ないと難燃性が低下する傾向があり、40重量%より多いと成形性が低下する傾向がある。本発明のエポキシ樹脂成形材料中に含まれるアセナフチレン構造の含有率は、難燃性と成形性の観点からは0.1～5重量%が好ましく、0.3～3重量%がより好ましい。0.1重量%より少ないと難燃性に劣る傾向にあり、5重量%より多いと成形性が低下する傾向にある。

## 【0047】

(A) エポキシ樹脂と (B) 硬化剤との当量比、すなわち、エポキシ樹脂中のエポキシ基数に対する硬化剤中の水酸基数の比 (硬化剤中の水酸基数／エポキシ樹脂中のエポキシ基数) は、特に制限はないが、それぞれの未反応分を少なく抑えるために 0.5～2 の範囲に設定されることが好ましく、0.6～1.3 がより好ましい。成形性及び耐リフロー性に優れる封止用エポキシ樹脂成形材料を得るために 0.8～1.2 の範囲に設定されることがさらに好ましい。

## 【0048】

本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料には、(A) エポキシ樹脂と (B) 硬化剤の反応を促進させるために必要に応じて (C) 硬化促進剤を用いることができる。(C) 硬化促進剤は、封止用エポキシ樹脂成形材料に一般に使用されているもので特に制限はないが、たとえば、1,8-ジアザービシクロ(5,4,0)ウンデセン-7、1,5-ジアザービシクロ(4,3,0)ノネン、5,6-ジブチルアミノ-1,8-ジアザービシクロ(5,4,0)ウンデセン-7 等のシクロアミジン化合物及びこれらの化合物に無水マレイン酸、1,4-ベンゾキノン、2,5-トルキノン、1,4-ナフトキノン、2,3-ジメチルベンゾキノン、2,6-ジメチルベンゾキノン、2,3-ジメトキシ-5-メチル-1,4-ベンゾキノン、2,3-ジメトキシ-1,4-ベンゾキノン、フェニル-1,4-ベンゾキノン等のキノン化合物、ジアゾフェニルメタン、フェノール樹脂等のπ結合をもつ化合物を付加してなる分子内分極を有する化合物、ベンジルジメチルアミン、トリエタノールアミン、ジメチルアミノエタノール、トリス(ジメチルアミノメチル)フェノール等の3級アミン類及びこれらの誘導体、2-メチルイミダゾール、2-フェニルイミダゾール、2-フェニル-4-メチルイミダゾール等のイミダゾール類及びこれらの誘導体、トリブチルホスфин、メチルジフェニルホスфин、トリフェニルホスфин、トリス(4-メチルフェニル)ホスфин、ジフェニルホスфин、フェニルホスфин等のホスфин化合物及びこれらのホスфин化合物に無水マレイン酸、上記キノン化合物、ジアゾフェニルメタン、フェノール樹脂等のπ結合をもつ化合物を付加してなる分子内分極を有するリン化合物、テトラフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート、トリフェニルホスфинテトラフェニルボレート、2-エチル-4-メチルイミダゾールテトラフェニルボレート、N-メチルモルホリンテトラフェニルボレート等のテトラフェニルボロン塩及びこれらの誘導体などが挙げられ、これらを単独で用いても2種以上を組み合わせて用いてもよい。

なかでも、難燃性、硬化性の観点からは、トリフェニルホスфинが好ましく、難燃性、硬化性、流動性及び離型性の観点からは第三ホスфин化合物とキノン化合物との付加物が好ましい。第三ホスфин化合物としては、特に限定するものではないが、トリシクロヘキシルホスфин、トリブチルホスфин、ジブチルフェニルホスфин、ブチルジフェニルホスфин、エチルジフェニルホスфин、トリフェニルホスфин、トリス(4-メチルフェニル)ホスфин、トリス(4-エチルフェニル)ホスфин、トリス(4-プロピルフェニル)ホスфин、トリス(4-ブチルフェニル)ホスфин、トリス(イソプロピルフェニル)ホスфин、トリス(t-ブチルフェニル)ホスфин、トリス(2,4-ジメチルフェニル)ホスфин、トリス(2,6-ジメチルフェニル)ホスфин、トリス(2,4,6-トリメチルフェニル)ホスфин、トリス(2,6-ジメチル-4-エトキシフェニル)ホスфин、トリス(4-メトキシフェニル)ホスфин、トリス(4-エトキシフェニル)ホスфинなどのアルキル基、アリール基を有する第三ホスфин化合物が好ましい。またキノン化合物としては o-ベンゾキノン、p-ベンゾキノン、ジフェノキノン、1,4-ナフトキノン、アントラキノン等があげられ、なかでも耐湿性、保存安定性の観点から p-ベンゾキノンが好ましい。トリス(4-メチルフェニル)ホスфинと p-ベンゾキノンとの付加物が離型性の観点からより好ましい。

## 【0049】

硬化促進剤の配合量は、硬化促進効果が達成される量であれば特に制限されるものではないが、封止用エポキシ樹脂成形材料に対して 0.005～2 重量% が好ましく、0.0

1～0.5重量%がより好ましい。0.005重量%未満では短時間での硬化性に劣る傾向があり、2重量%を超えると硬化速度が速すぎて良好な成形品を得ることが困難になる傾向がある。

#### 【0050】

本発明では必要に応じて(D)無機充填剤を配合することができる。無機充填剤は、吸湿性、線膨張係数低減、熱伝導性向上及び強度向上の効果があり、たとえば、溶融シリカ、結晶シリカ、アルミナ、ジルコン、珪酸カルシウム、炭酸カルシウム、チタン酸カリウム、炭化珪素、窒化珪素、窒化アルミ、窒化ホウ素、ベリリア、ジルコニア、ジルコン、フォステライト、ステアタイト、スピネル、ムライト、チタニア等の粉体、又はこれらを球形化したビーズ、ガラス纖維等が挙げられる。さらに、難燃効果のある無機充填剤としては水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、複合金属水酸化物、硼酸亜鉛、モリブデン酸亜鉛などが挙げられる。ここで、ホウ酸亜鉛としてはFB-290、FB-500(U. S. Borax社製)、FRZ-500C(水澤化学社製)等が、モリブデン酸亜鉛としてはKEMGARD 911B、911C、1100(Sherwin-Williams社製)等が各々市販品として入手可能である。

これらの無機充填剤は単独で用いても2種以上を組み合わせて用いてもよい。なかでも、充填性、線膨張係数の低減の観点からは溶融シリカが、高熱伝導性の観点からはアルミナが好ましく、無機充填剤の形状は充填性及び金型摩耗性の点から球形が好ましい。

無機充填剤の配合量は、難燃性、成形性、吸湿性、線膨張係数低減、強度向上及び耐リフロー性の観点から、封止用エポキシ樹脂組成物に対して50質量%以上が好ましく、60～95質量%がより好ましく、70～90質量%がさらに好ましい。60質量%未満では難燃性及び耐リフロー性が低下する傾向があり、95質量%を超えると流動性が不足する傾向があり、また難燃性も低下する傾向にある。

#### 【0051】

(D)無機充填剤を用いる場合、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料には、樹脂成分と充填剤との接着性を高めるために、(E)カップリング剤をさらに配合することが好ましい。(E)カップリング剤としては、封止用エポキシ樹脂成形材料に一般に使用されているもので特に制限はないが、たとえば、1級及び/又は2級及び/又は3級アミノ基を有するシラン化合物、エポキシシラン、メルカプトシラン、アルキルシラン、ウレイドシラン、ビニルシラン等の各種シラン系化合物、チタン系化合物、アルミニウムキレート類、アルミニウム/ジルコニウム系化合物等が挙げられる。これらを例示すると、ビニルトリクロロシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリス(β-メトキシエトキシ)シラン、γ-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、β-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシラン、γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γ-グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、γ-メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ-アミノプロピルトリメトキシシラン、γ-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン、γ-(N,N-ジメチル)アミノプロピルトリメトキシシラン、γ-(N,N-ジエチル)アミノプロピルトリメトキシシラン、γ-(N,N-ジブチル)アミノプロピルトリメトキシシラン、γ-(N-メチル)アニリノプロピルトリメトキシシラン、γ-(N-エチル)アニリノプロピルトリメトキシシラン、γ-(N,N-ジメチル)アミノプロピルトリエトキシシラン、γ-(N,N-ジエチル)アミノプロピルトリエトキシシラン、γ-(N,N-ジブチル)アミノプロピルトリエトキシシラン、γ-(N-メチル)アニリノプロピルメチルジメトキシシラン、γ-(N,N-ジメチル)アミノプロピルメチルジメトキシシラン、γ-(N,N-ジエチル)アミノプロピルメチルジメトキシシラン、γ-(N,N-ジブチル)アミノプロピルメチルジメトキシシラン、γ-(N-エチル)アニリノプロピルメチルジメトキシシラン、N-(トリメトキシシリルプロピル)エチレンジアミン、N-

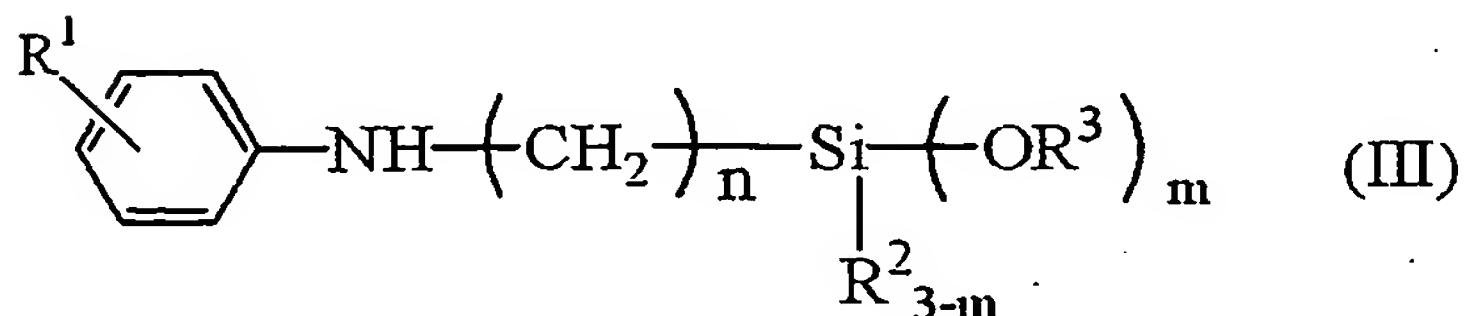
(ジメトキシメチルシリルイソプロピル)エチレンジアミン、メチルトリメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、 $\gamma$ -クロロプロピルトリメトキシシラン、ヘキサメチルジシラン、ビニルトリメトキシシラン、 $\gamma$ -メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン等のシラン系カップリング剤、イソプロピルトリイソステアロイルチタネート、イソプロピルトリス(ジオクチルバイロホスフェート)チタネート、イソプロピルトリ(N-アミノエチル-アミノエチル)チタネート、テトラオクチルビス(ジトリデシルホスファイト)チタネート、テトラ(2,2-ジアリルオキシメチル-1-ブチル)ビス(ジトリデシル)ホスファイトチタネート、ビス(ジオクチルバイロホスフェート)オキシアセテートチタネート、ビス(ジオクチルバイロホスフェート)エチレンチタネート、イソプロピルトリオクタノイルチタネート、イソプロピルジメタクリルイソステアロイルチタネート、イソプロピルトリドデシルベンゼンスルホニルチタネート、イソプロピルイソステアロイルジアクリルチタネート、イソプロピルトリ(ジオクチルホスフェート)チタネート、イソプロピルトリクミルフェニルチタネート、テトライソプロピルビス(ジオクチルホスファイト)チタネート等のチタネート系カップリング剤などが挙げられ、これらの1種を単独で用いても2種類以上を組み合わせて用いてもよい。

### 【0052】

なかでも流動性、難燃性の観点からは2級アミノ基を有するシランカップリング剤が好ましい。2級アミノ基を有するシランカップリング剤は分子内に2級アミノ基を有するシラン化合物であれば特に制限はないが、たとえば、 $\gamma$ -アニリノプロピルトリメトキシシラン、 $\gamma$ -アニリノプロピルトリエトキシシラン、 $\gamma$ -アニリノプロピルメチルジメトキシシラン、 $\gamma$ -アニリノプロピルメチルジエトキシシラン、 $\gamma$ -アニリノプロピルエチルジエトキシシラン、 $\gamma$ -アニリノプロピルエチルジメトキシシラン、 $\gamma$ -アニリノメチルトリメトキシシラン、 $\gamma$ -アニリノメチルトリエトキシシラン、 $\gamma$ -アニリノメチルメチルジメトキシシラン、 $\gamma$ -アニリノメチルメチルジエトキシシラン、 $\gamma$ -アニリノメチルエチルジメトキシシラン、 $\gamma$ -アニリノメチルエチルジメトキシシラン、 $\gamma$ -アニリノメチルエチルジエトキシシラン、 $\gamma$ -アニリノメチルエチルジメトキシシラン、 $N$ -(p-メトキシフェニル)- $\gamma$ -アミノプロピルトリメトキシシラン、 $N$ -(p-メトキシフェニル)- $\gamma$ -アミノプロピルメチルジメトキシシラン、 $N$ -(p-メトキシフェニル)- $\gamma$ -アミノプロピルエチルジエトキシシラン、 $N$ -(p-メトキシフェニル)- $\gamma$ -アミノプロピルエチルジメトキシシラン、 $\gamma$ -(N-メチル)アミノプロピルトリメトキシシラン、 $\gamma$ -(N-エチル)アミノプロピルトリメトキシシラン、 $\gamma$ -(N-ブチル)アミノプロピルトリメトキシシラン、 $\gamma$ -(N-ベンジル)アミノプロピルトリメトキシシラン、 $\gamma$ -(N-エチル)アミノプロピルトリエトキシシラン、 $\gamma$ -(N-ブチル)アミノプロピルトリエトキシシラン、 $\gamma$ -(N-メチル)アミノプロピルメチルジメトキシシラン、 $\gamma$ -(N-エチル)アミノプロピルメチルジメトキシシラン、 $\gamma$ -(N-ブチル)アミノプロピルメチルジメトキシシラン、 $\gamma$ -(N-ベンジル)アミノプロピルメチルジメトキシシラン、 $N$ - $\beta$ -(アミノエチル)- $\gamma$ -アミノプロピルトリメトキシシラン、 $\gamma$ -( $\beta$ -アミノエチル)アミノプロピルトリメトキシシラン、 $N$ - $\beta$ -(N-ビニルベンジルアミノエチル)- $\gamma$ -アミノプロピルトリメトキシシラン等が挙げられる。なかでも下記一般式(III)で示されるアミノシランカップリング剤が特に好ましい。

### 【0053】

#### 【化18】



(ここで、 $\text{R}^1$ は水素原子、炭素数1~6のアルキル基及び炭素数1~2のアル

コキシ基から選ばれ、R<sup>2</sup> は炭素数1～6のアルキル基及びフェニル基から選ばれ、R<sup>3</sup> はメチル基又はエチル基を示し、nは1～6の整数を示し、mは1～3の整数を示す。)

## 【0054】

カップリング剤の全配合量は、封止用エポキシ樹脂組成物に対して0.037～4.75質量%であることが好ましく、0.05～5質量%であることがより好ましく、0.1～2.5質量%であることがさらに好ましい。0.037質量%未満ではフレームとの接着性が低下する傾向があり、4.75質量%を超えるとパッケージの成形性が低下する傾向がある。

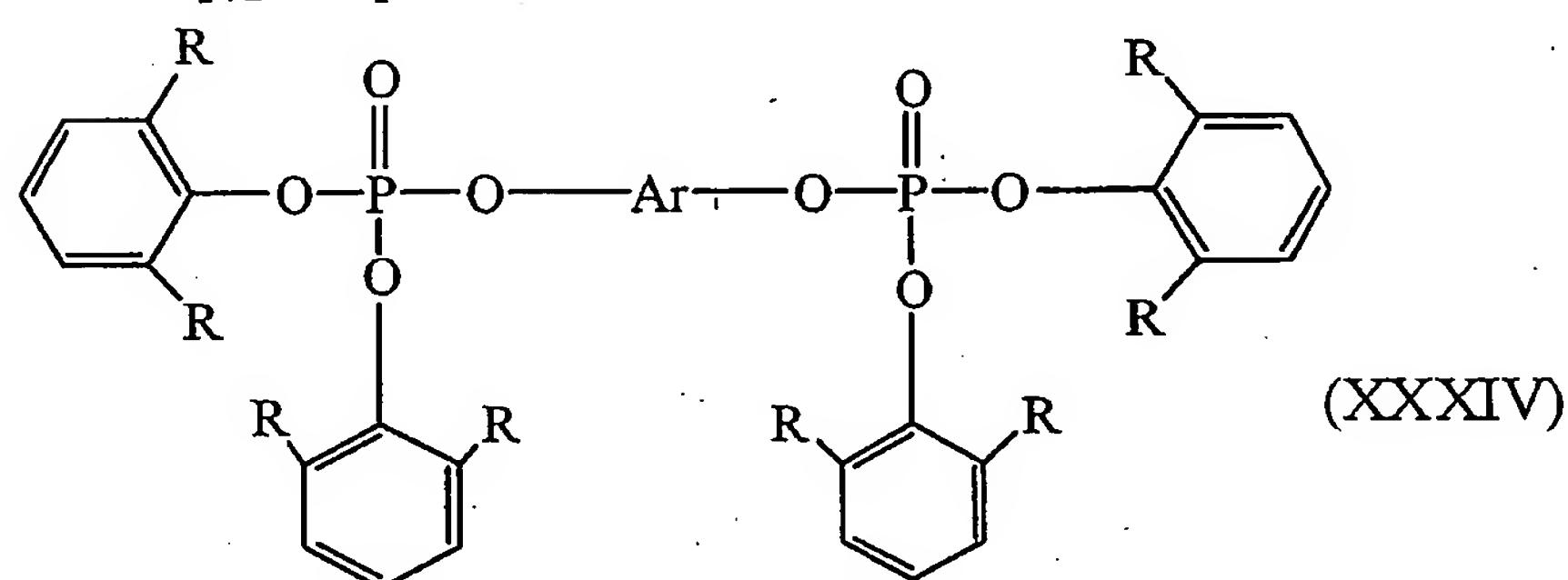
## 【0055】

本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料には、さらに難燃性を向上する目的で従来公知のノンハロゲン、ノンアンチモンの難燃剤を必要に応じて配合することができる。たとえば、赤リン、酸化亜鉛等の無機化合物とフェノール樹脂等の熱硬化性樹脂で被覆された赤リン及びリン酸エステル、ホスフィンオキサイド等のリン化合物、メラミン、メラミン誘導体、メラミン変性フェノール樹脂、トリアジン環を有する化合物、シアヌル酸誘導体、イソシアヌル酸誘導体等の窒素含有化合物、シクロホスファゼン等のリン及び窒素含有化合物、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、複合金属水酸化物、酸化亜鉛、錫酸亜鉛、硼酸亜鉛、酸化鉄、酸化モリブデン、モリブデン酸亜鉛、ジシクロペンタジエニル鉄等の金属元素を含む化合物などが挙げられ、これらの1種を単独で用いても2種以上を組合させて用いてもよい。

なかでも流動性の観点からは、リン酸エステル、ホスフィンオキサイド及びシクロホスファゼンが好ましい。リン酸エステルはリン酸とアルコール化合物又はフェノール化合物のエステル化合物であれば特に制限はないが、例えばトリメチルホスフェート、トリエチルホスフェート、トリフェニルホスフェート、トリクレジルホスフェート、トリキシレニルホスフェート、クレジルジフェニルホスフェート、キシレニルジフェニルホスフェート、トリス(2,6ジメチルフェニル)ホスフェート及び芳香族縮合リン酸エステル等が挙げられる。なかでも耐加水分解性の観点からは、下記一般式(XXXIV)で示される芳香族縮合リン酸エステルが好ましい。

## 【0056】

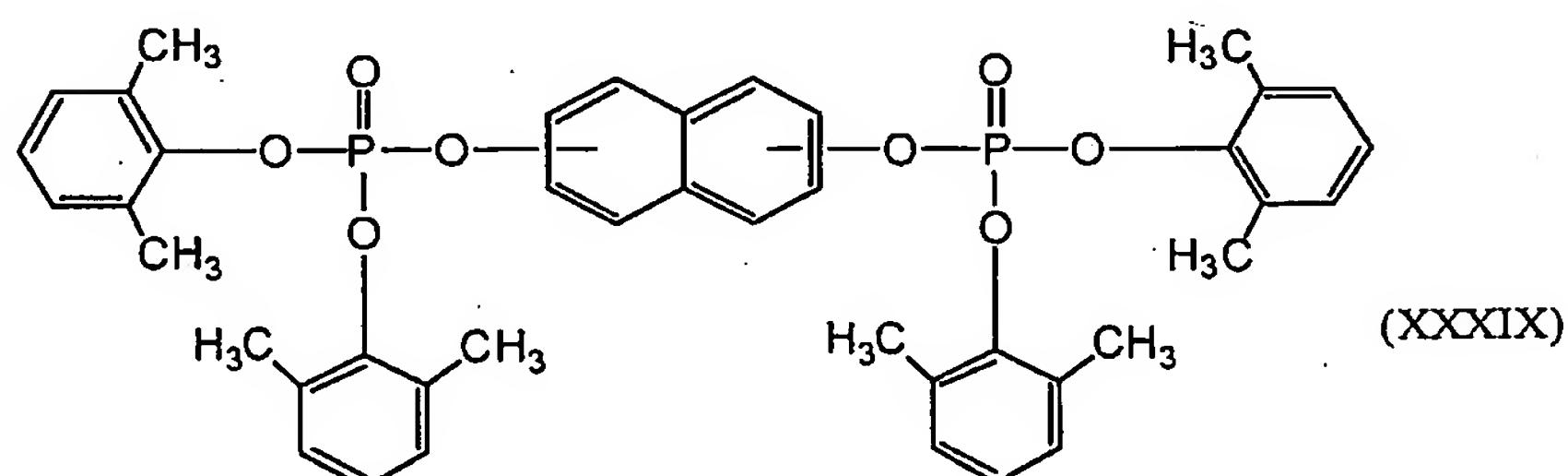
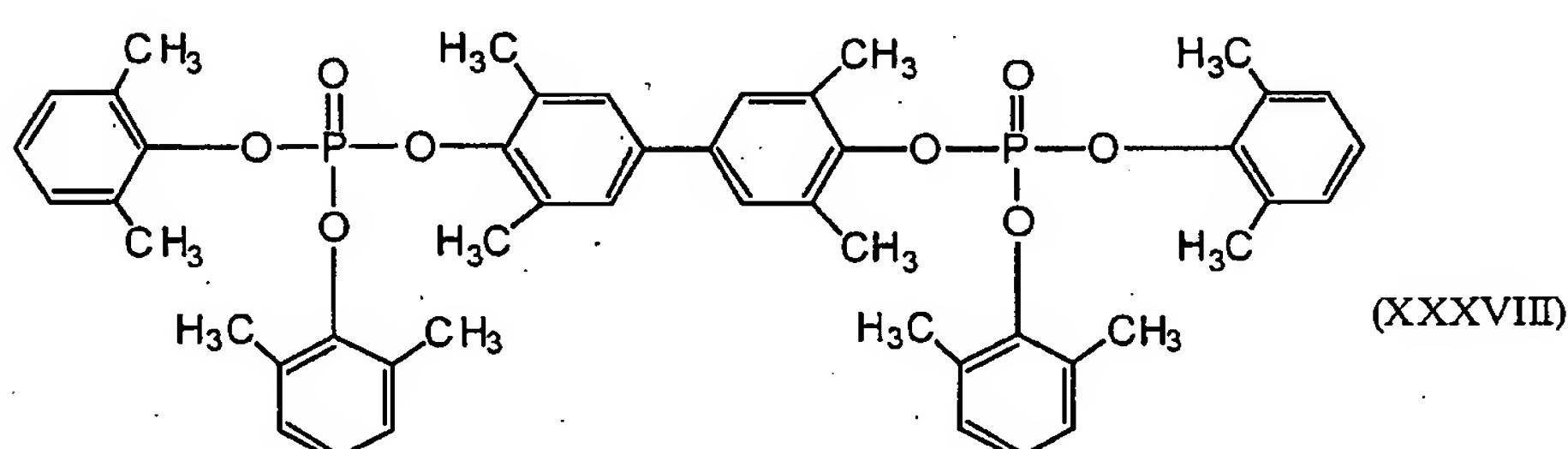
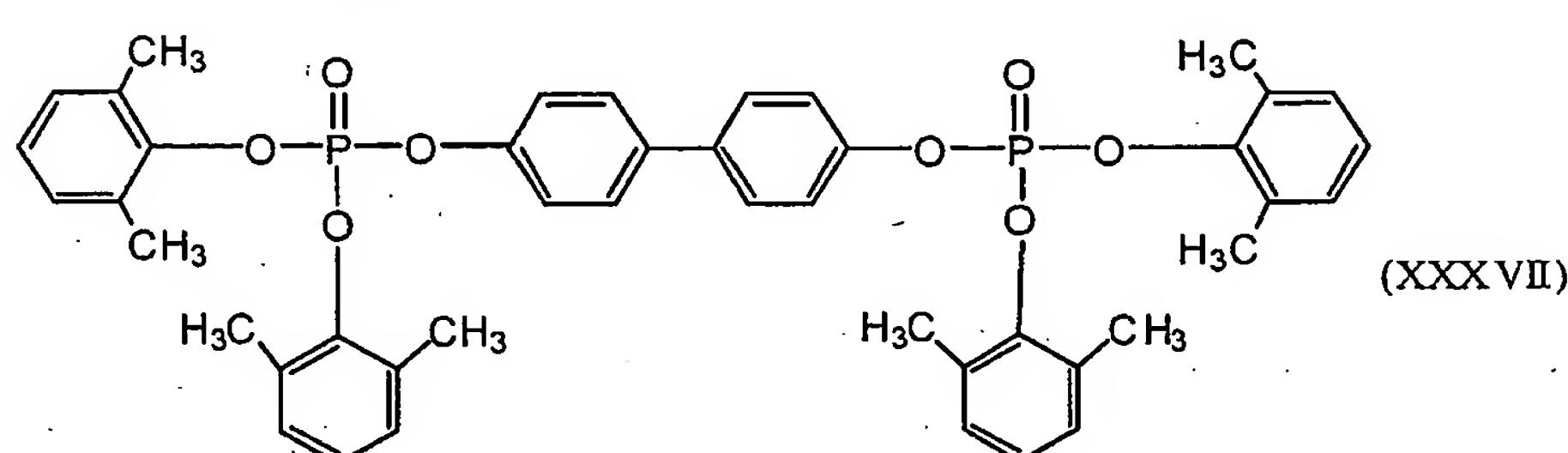
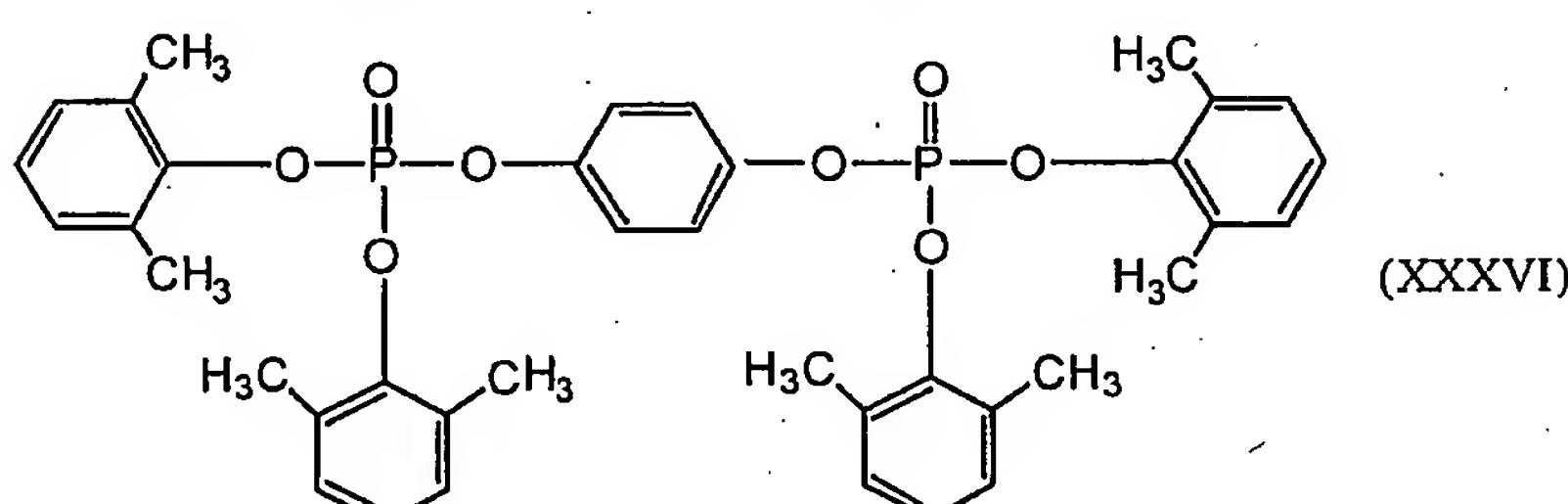
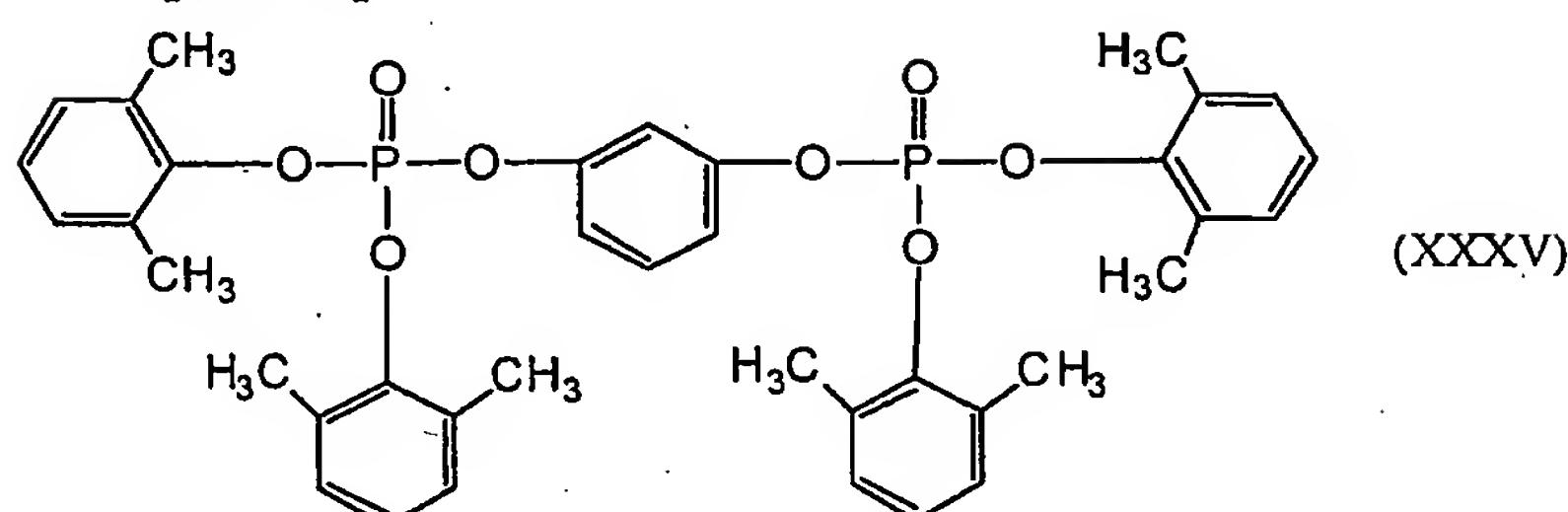
## 【化19】



上記式(XXXIV)のリン酸エステルを例示すると、下記構造式(XXXV)～(XXXIX)で示されるリン酸エステル等が挙げられる。

【0057】

【化20】



【0058】

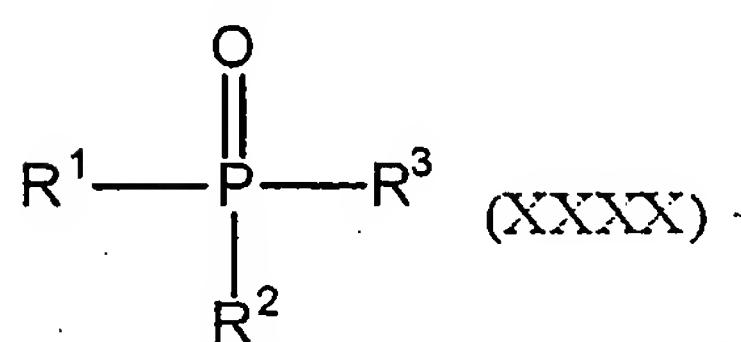
これらリン酸エステルの添加量は、充填剤を除く他の全配合成分に対して、磷原子の量で0.2～3.0重量%の範囲内であることが好ましい。0.2重量%より少ない場合は難燃効果が低くなる傾向がある。3.0重量%を超えた場合は成形性、耐湿性の低下や、成形時にこれらのリン酸エステルがしみ出し、外観を阻害する場合がある。

## 【0059】

ホスフィンオキサイドを難燃剤として用いる場合、ホスフィンオキサイドとしては下記一般式 (XXXX) で示される化合物が好ましい。

## 【0060】

## 【化21】



(ここで、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup> 及びR<sup>3</sup> は炭素数1～10の置換又は非置換のアルキル基、アリール基、アラルキル基及び水素原子を示し、すべて同一でも異なってもよい。ただしすべてが水素原子である場合を除く。)

上記一般式 (XXXX) で示されるリン化合物の中でも、耐加水分解性の観点からはR<sup>1</sup>～R<sup>3</sup> が置換又は非置換のアリール基であることが好ましく、特に好ましくはフェニル基である。

## 【0061】

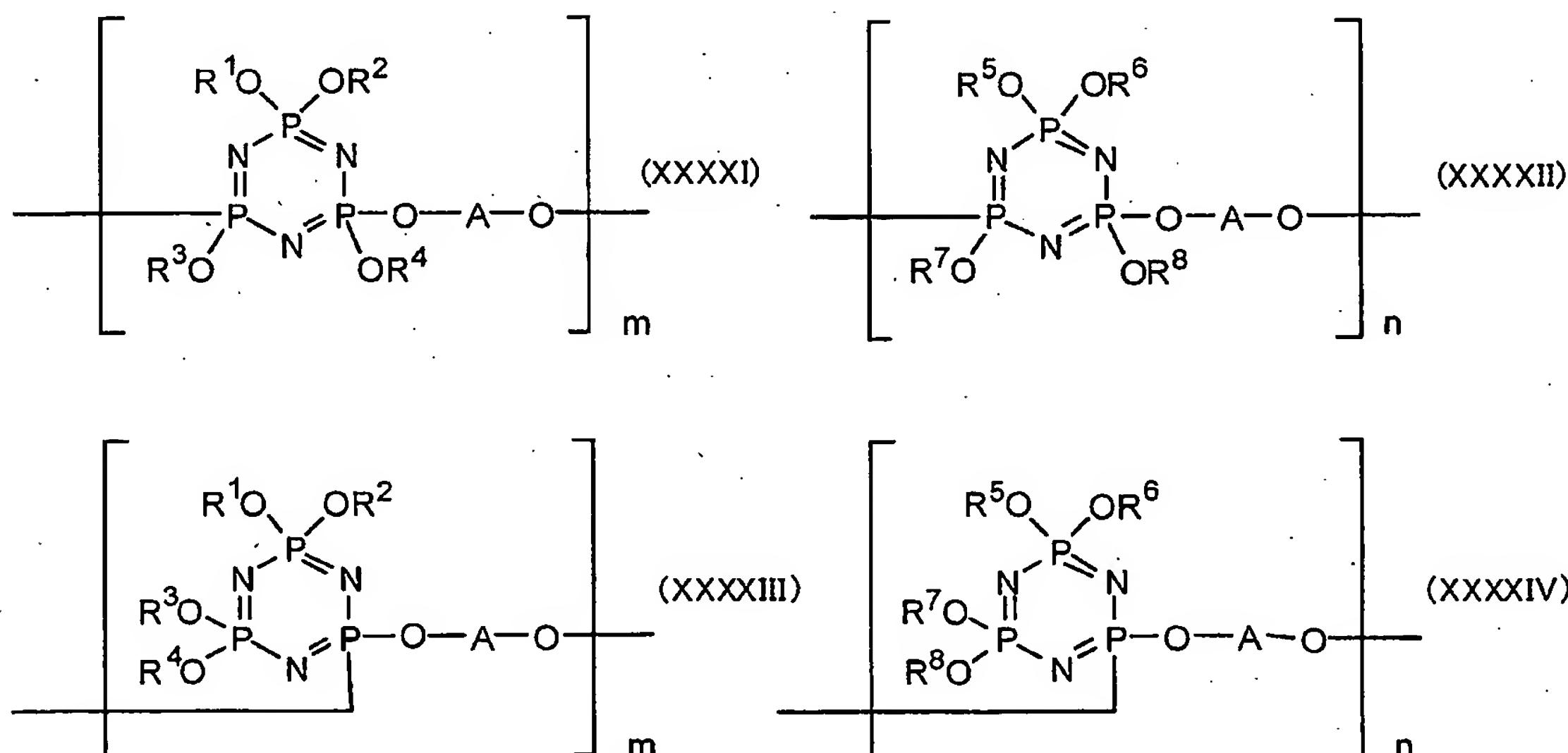
ホスフィンオキサイドの配合量は封止用エポキシ樹脂成形材料に対してリン原子の量が0.01～0.2質量%であることが必要である。好ましくは0.02～0.1質量%であり、さらに好ましくは0.03～0.08質量%である。0.01質量%未満であると難燃性が低下し、0.2質量%を超えると成形性、耐湿性が低下する。

## 【0062】

シクロホスファゼンとしては主鎖骨格中に次式 (XXXXI) 及び／又は次式 (XXXXII) を繰り返し単位として含む環状ホスファゼン化合物、あるいはホスファゼン環中の燐原子に対する置換位置が異なる次式 (XXXXIII) 及び／又は次式 (XXXXIV) を繰り返し単位として含む化合物等が挙げられる。

## 【0063】

## 【化22】



ここで、式 (XXXXI) 及び式 (XXXXIII) 中のmは1～10の整数で、R<sup>1</sup>～R<sup>4</sup> は置換基を有しても良い炭素数1～12のアルキル基、アリール基及び水酸基から選ばれ、全て同一でも異なっていても良い。Aは炭素数1～4のアルキレン基又はアリレン基を示す。式 (XXXXII) 及び式 (XXXXIV) 中のnは1～10の整数で、R<sup>5</sup>～R<sup>8</sup> は置換基を有しても良い炭素数1～12のアルキル基又はアリール基から選ばれ、全て同一でも異なっていても良く、Aは炭素数1～4のアルキレン基又はアリレン基を示す。

す。また、式中m個のR<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>はm個全てが同一でも異なっていても良く、n個のR<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup>、R<sup>8</sup>はn個全てが同一でも異なっていても良い。上記式(XXXXI)～式(XXXXIV)において、R<sup>1</sup>～R<sup>8</sup>で示される置換基を有しても良い炭素数1～12のアルキル基又はアリール基としては特に制限はないが、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基等のアルキル基、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基等のアリール基、o-トトリル基、m-トトリル基、p-トトリル基、2,3-キシリル基、2,4-キシリル基、o-クメニル基、m-クメニル基、p-クメニル基、メシチル基等のアルキル基置換アリール基、ベンジル基、フェネチル基等のアリール基置換アルキル基などが挙げられ、さらにこれらに置換する置換基としては、アルキル基、アルコキシル基、アリール基、水酸基、アミノ基、エポキシ基、ビニル基、ヒドロキシアルキル基、アルキルアミノ基等が挙げられる。

これらの中で、エポキシ樹脂成形材料の耐熱性、耐湿性の観点からはアリール基が好ましく、より好ましくはフェニル基もしくはヒドロキシフェニル基である。

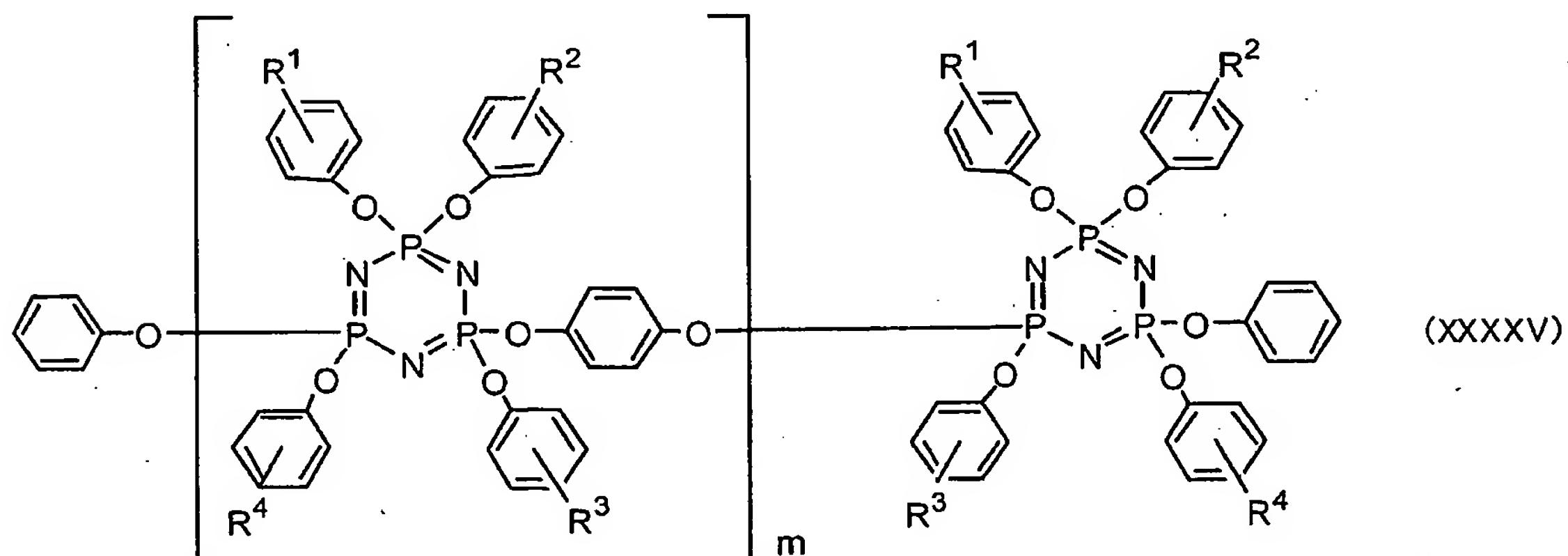
また、上記式(XXXXI)～式(XXXXIV)中のAで示される炭素数1～4のアルキレン基又はアリレン基としては特に制限はないが、例えばメチレン基、エチレン基、プロピレン基、イソプロピレン基、ブチレン基、イソブチレン基、フェニレン基、トリレン基、キシリレン基、ナフチレン基等が挙げられ、エポキシ樹脂成形材料の耐熱性、耐湿性の観点からはアリレン基が好ましく、中でもフェニレン基がより好ましい。

環状ホスファゼン化合物は、上記式(XXXXI)～式(XXXXIV)のいずれかの重合物、上記式(XXXXI)と上記式(XXXXII)との共重合物、又は上記式(XXXXIII)と上記式(XXXXIV)との共重合物であるが、共重合物の場合、ランダム共重合物でも、ブロック共重合物でも、交互共重合物のいずれでも良い。その共重合モル比m/nは特に限定するものではないが、エポキシ樹脂硬化物の耐熱性や強度向上の観点から1/0～1/4が好ましく、1/0～1/1.5がより好ましい。また、重合度m+nは1～20であり、好ましくは2～8、より好ましくは3～6である。

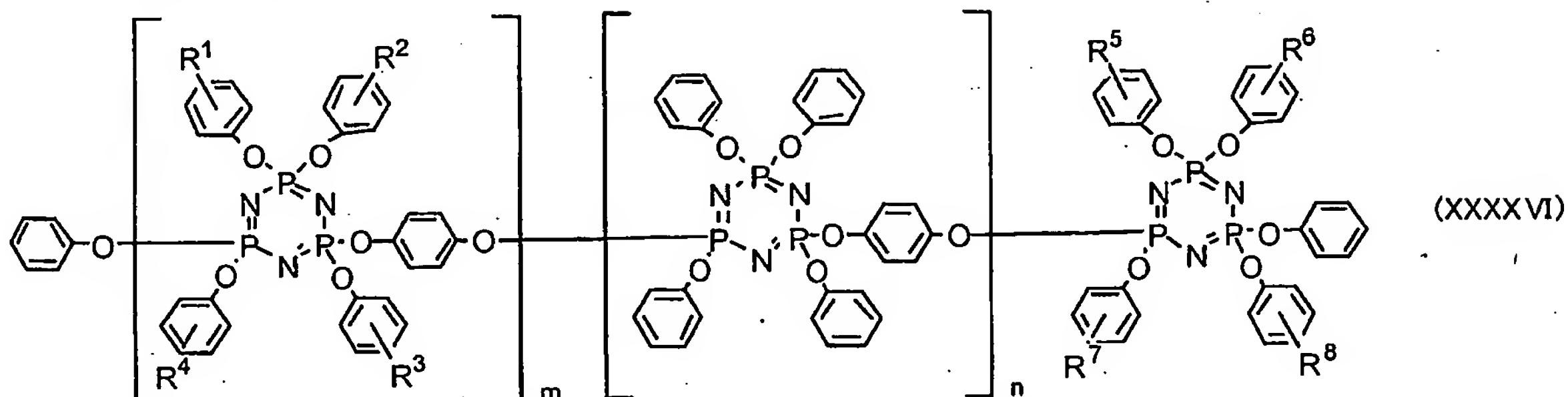
環状ホスファゼン化合物として好ましいものを例示すると、次式(XXXXV)の重合物、次式(XXXXVI)の共重合物等が挙げられる。

【0064】

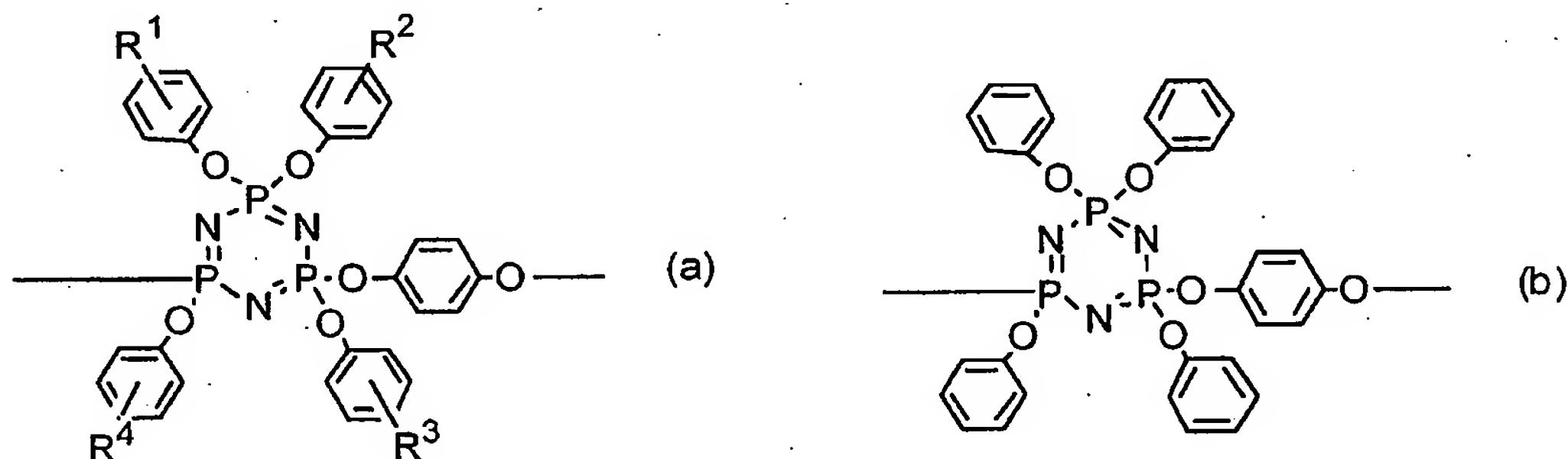
【化23】



(ここで、式(XXXXV)中のmは、0～9の整数で、R<sup>1</sup>～R<sup>4</sup>はそれぞれ独立に水素又は水酸基を示す。)

【0065】  
【化24】

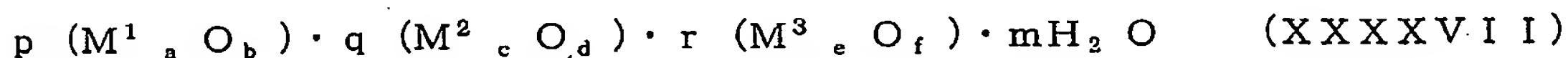
ここで、上記式 (XXXXVI) 中の  $m$ 、 $n$  は、0～9の整数で、 $R^1$ ～ $R^4$  はそれぞれ独立に水素または水酸基から選ばれ、 $R^5$ ～ $R^8$  はそれぞれ独立に水素または水酸基から選ばれる。また、上記式 (XXXXVI) で示される環状ホスファゼン化合物は、次に示す  $m$  個の繰り返し単位 (a) と  $n$  個の繰り返し単位 (b) を交互に含むもの、ブロック状に含むもの、ランダムに含むもののいずれであってもかまわないが、ランダムに含むものが好ましい。

【0066】  
【化25】

中でも、上記式 (XXXXV) で  $m$  が 3～6 の重合体を主成分とするものや、上記式 (XXXXVI) で  $R^5$ ～ $R^8$  が全て水素又は1つが水酸基であり、 $m/n$  が  $1/2 \sim 1/3$  で、 $m+n$  が 3～6 の共重合体を主成分とするものが好ましい。また、市販のホスファゼン化合物としては、SPE-100 (大塚化学製商品名) が入手可能である。

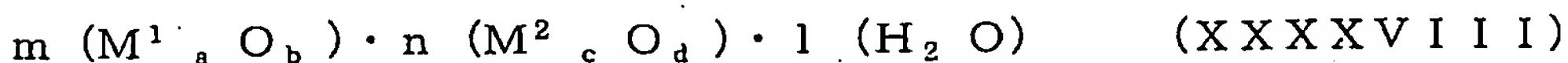
【0067】

複合金属水酸化物を難燃剤として用いる場合、複合金属水酸化物は下記組成式 (XXXXVII) で示される化合物が好ましい。

【0068】  
【化26】

(ここで、 $M^1$ 、 $M^2$  及び  $M^3$  は互いに異なる金属元素を示し、 $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$ 、 $e$ 、 $f$ 、 $p$ 、 $q$  及び  $m$  は正の数、 $r$  は 0 又は正の数を示す。)

なかでも、上記組成式 (XXXXVII) 中の  $r$  が 0 である化合物、すなわち、下記組成式 (XXXXVIII) で示される化合物がさらに好ましい。

【0069】  
【化27】

(ここで、 $M^1$  及び  $M^2$  は互いに異なる金属元素を示し、 $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$ 、 $m$ 、 $n$  及び  $l$  は正の数を示す。)

上記組成式 (XXXXVII) 及び (XXXXVIII) 中の  $M^1$  、  $M^2$  及び  $M^3$  は互いに異なる金属元素であれば特に制限はないが、難燃性の観点からは、  $M^1$  と  $M^2$  が同一となならないように  $M^1$  が第3周期の金属元素、 IIA 族のアルカリ土類金属元素、 IVB 族、 IIB 族、 VIIII 族、 IB 族、 IIIA 族及び IVA 族に属する金属元素から選ばれ、  $M^2$  が IIB~IIB 族の遷移金属元素から選ばれが好ましく、  $M^1$  がマグネシウム、カルシウム、アルミニウム、スズ、チタン、鉄、コバルト、ニッケル、銅及び亜鉛から選ばれ、  $M^2$  が鉄、コバルト、ニッケル、銅及び亜鉛から選ばれがより好ましい。流動性の観点からは、  $M^1$  がマグネシウム、  $M^2$  が亜鉛又はニッケルであることが好ましく、  $M^1$  がマグネシウムで  $M^2$  が亜鉛であることがより好ましい。

上記組成式 (XXXXVII) 中の  $p$  、  $q$  、  $r$  のモル比は本発明の効果が得られれば特に制限はないが、  $r = 0$  で、  $p$  及び  $q$  のモル比  $p/q$  が  $99/1 \sim 50/50$  であることが好ましい。すなわち、上記組成式 (XXXXVIII) 中の  $m$  及び  $n$  のモル比  $m/n$  が  $99/1 \sim 50/50$  であることが好ましい。

市販品としては、例えば、上記組成式 (XXXXVIII) の  $M^1$  がマグネシウム、  $M^2$  が亜鉛で、  $m$  が 7 、  $n$  が 3 、  $l$  が 10 で、  $a$  、  $b$  、  $c$  及び  $d$  が 1 である水酸化マグネシウム・水酸化亜鉛固溶体複合金属水酸化物（タテホ化学工業株式会社製商品名エコーマグ Z-10）を使用できる。なお、金属元素とは半金属元素といわれるものも含めるものとし、非金属元素を除く全ての元素をさす。

なお、金属元素の分類は、典型元素を A 族、遷移元素を B 族とする長周期型の周期率表（出典：共立出版株式会社発行「化学大辞典4」1987年2月15日縮刷版第30刷）に基づいて行った。

#### 【0070】

複合金属水酸化物の形状は特に制限はないが、流動性、充填性の観点からは、平板状より、適度の厚みを有する多面体形状が好ましい。複合金属水酸化物は、金属水酸化物と比較して多面体状の結晶が得られやすい。

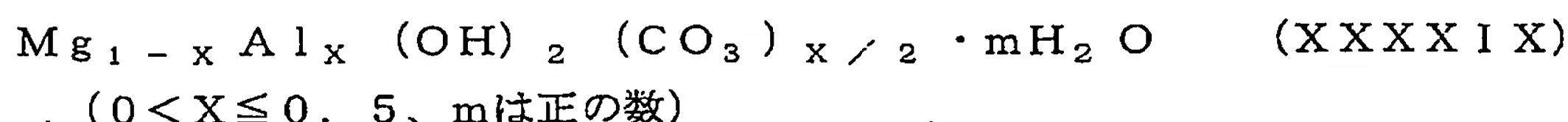
複合金属水酸化物の配合量は特に制限はないが、封止用エポキシ樹脂成形材料に対して  $0.5 \sim 2.0$  質量%が好ましく、  $0.7 \sim 1.5$  質量%がより好ましく、  $1.4 \sim 1.2$  質量%がさらに好ましい。  $0.5$  質量%未満では難燃性が不十分となる傾向があり、  $2.0$  質量%を超えると流動性及び耐リフロー性が低下する傾向がある。

#### 【0071】

また、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料には、 IC 等の半導体素子の耐湿性及び高温放置特性を向上させる観点から陰イオン交換体を添加することもできる。陰イオン交換体としては特に制限はなく、従来公知のものを用いることができるが、たとえば、ハイドロタルサイト類や、マグネシウム、アルミニウム、チタン、ジルコニウム、ビスマス等から選ばれる元素の含水酸化物等が挙げられ、これらを単独又は 2 種以上を組み合わせて用いることができる。なかでも、下記組成式 (XXXXIX) で示されるハイドロタルサイトが好ましい。

#### 【0072】

#### 【化28】



#### 【0073】

さらに、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料には、その他の添加剤として、高級脂肪酸、高級脂肪酸金属塩、エステル系ワックス、ポリオレフィン系ワックス、ポリエチレン、酸化ポリエチレン等の離型剤、カーボンブラック等の着色剤、シリコーンオイルやシリコーンゴム粉末等の応力緩和剤などを必要に応じて配合することができる。

#### 【0074】

本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料は、難燃性の観点から (A) エポキシ樹脂と (B) 硬化剤を予め溶融混合して用いることが好ましい。溶融混合する方法は特に制限は無い

が、両者あるいは一方が溶融する温度以上に加熱して、攪拌し、均一になるまで混合する。この際、ゲル化しないよう、G P C (ゲルパーミエーションクロマトグラフィー)、F T-I R等を使用して反応性を確認し、最適な条件を設定することが好ましい。(A)エポキシ樹脂として上記一般式(I)の化合物を、(B)硬化剤として上記一般式(II)の化合物を使用する際は80~120℃、好ましくは90~120℃で10~60分、好ましくは20~40分攪拌溶融混合することが好ましい。

#### 【0075】

本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料は、各種原材料を均一に分散混合できるのであれば、いかなる手法を用いても調製できるが、一般的な手法として、所定の配合量の原材料をミキサー等によって十分混合した後、ミキシングロール、押出機、らいかい機、プラネットリミキサ等によって混合又は溶融混練した後、冷却し、必要に応じて脱泡、粉碎する方法等を挙げることができる。また、必要に応じて成形条件に合うような寸法及び重量でタブレット化してもよい。

#### 【0076】

本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料を封止材として用いて、半導体装置等の電子部品装置を封止する方法としては、低圧トランスファ成形法が最も一般的であるが、インジェクション成形法、圧縮成形法等も挙げられる。ディスペンス方式、注型方式、印刷方式等を用いてもよい。

#### 【0077】

本発明で得られる封止用エポキシ樹脂組成物により封止した素子を備えた本発明の電子部品装置としては、リードフレーム、配線済みのテープキャリア、配線板、ガラス、シリコンウェハ等の支持部材や実装基板に、半導体チップ、トランジスタ、ダイオード、サイリスタ等の能動素子、コンデンサ、抵抗体、コイル等の受動素子等の素子を搭載し、必要な部分を本発明の封止用エポキシ樹脂組成物で封止した、電子部品装置等が挙げられる。

#### 【0078】

ここで、実装基板としては特に制限するものではなく、たとえば、有機基板、有機フィルム、セラミック基板、ガラス基板等のインターポーラ基板、液晶用ガラス基板、MCM (Multi Chip Module) 用基板、ハイブリットIC用基板等が挙げられる。

このような素子を備えた電子部品装置としては、たとえば半導体装置が挙げられ、具体的には、リードフレーム (アイランド、タブ) 上に半導体チップ等の素子を固定し、ボンディングパッド等の素子の端子部とリード部をワイヤボンディングやバンプで接続した後、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料を用いてトランスファ成形などにより封止してなる、DIP (Dual Inline Package)、PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier)、QFP (Quad Flat Package)、SOP (Small Outline Package)、SOJ (Small Outline J-lead package)、TSOP (Thin Small Outline Package)、TQFP (Thin Quad Flat Package) 等の樹脂封止型IC、テープキャリアにリードボンディングした半導体チップを、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料で封止したTCP (Tape Carrier Package)、配線板やガラス上に形成した配線に、ワイヤボンディング、フリップチップボンディング、はんだ等で接続した半導体チップを、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料で封止したCOB (Chip On Board)、COG (Chip On Glass) 等のペアチップ実装した半導体装置、配線板やガラス上に形成した配線に、ワイヤボンディング、フリップチップボンディング、はんだ等で接続した半導体チップ、トランジスタ、ダイオード、サイリスタ等の能動素子及び/又はコンデンサ、抵抗体、コイル等の受動素子を、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料で封止したハイブリッドIC、MCM (Multi Chip Module) マザーボード接続用の端子を形成したインターポーラ基板に半導体チップを搭載し、バンプまたはワイヤボンディングにより半導体チップとインターポーラ基板に形成された配線を接続した後、本発明の封止用エ

ポキシ樹脂成形材料で半導体チップ搭載側を封止したBGA (Ball Grid Array)、CSP (Chip Size Package)、MCP (Multi Chip Package) などが挙げられる。また、これらの半導体装置は、実装基板上に素子が2個以上重なった形で搭載されたスタックド（積層）型パッケージであっても、2個以上の素子を一度に封止用エポキシ樹脂成形材料で封止した一括モールド型パッケージであってもよい。

【実施例】

【0079】

次に実施例により本発明を説明するが、本発明の範囲はこれらの実施例に限定されるものではない。

（実施例1～24、比較例1～14）

エポキシ樹脂として、エポキシ当量180、融点105℃の上記一般式（IV）で示されるエポキシ樹脂（ジャパンエポキシレジン株式会社製商品名エピコートYL-7172）（エポキシ樹脂1）、エポキシ当量273、軟化点58℃のビフェニレン型エポキシ樹脂（日本化薬株式会社製商品名NC-3000）（エポキシ樹脂2）、エポキシ当量196、融点106℃のビフェニル型エポキシ樹脂（ジャパンエポキシレジン株式会社製商品名エピコートYX-4000H）（エポキシ樹脂3）、エポキシ当量245、融点110℃の硫黄原子含有エポキシ樹脂（東都化成株式会社製商品名YSLV-120TE）（エポキシ樹脂4）及びエポキシ当量195、軟化点65℃のオークレゾールノボラック型エポキシ樹脂（住友化学工業株式会社製商品名ESCN-190）（エポキシ樹脂5）、硬化剤として軟化点70℃、水酸基当量175のフェノール・アラルキル樹脂（三井化学株式会社製商品名ミレックスXLC-3L）（硬化剤1）、軟化点80℃、水酸基当量199のビフェニレン型フェノール樹脂（明和化成株式会社製商品名MEH-7851）（硬化剤2）、水酸基当量182、軟化点67℃のβ-ナフトール・アラルキル樹脂（新日鐵化学株式会社製商品名SN-170）（硬化剤3）、水酸基当量199、軟化点78℃のアセナフチレン含有β-ナフトール・アラルキル樹脂（新日鐵化学株式会社製商品名SN-170AR-10）（硬化剤4）及び軟化点80℃、水酸基当量106のフェノールノボラック樹脂（明和化成株式会社製商品名H-1）（硬化剤5）、硬化促進剤としてトリフェニルホスフィン（硬化促進剤1）、トリフェニルホスフィンと1,4-ベンゾキノンの付加物（硬化促進剤2）、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデセン-7（硬化促進剤3）、カップリング剤としてγ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン（エポキシシラン）、2級アミノ基を含有するシランカップリング剤（γ-アニリノプロピルトリメトキシシラン（アニリノシラン）、難燃剤として芳香族縮合リン酸エステル（大八化学製商品名PX-200）、トリフェニルホスフィンオキサイド、シクロホスファゼン（大塚化学株式会社製商品名SPE-100）、水酸化マグネシウム・水酸化亜鉛固溶体複合金属水酸化物（タテホ化学工業株式会社製商品名エコーマグZ-10）、モリブデン酸亜鉛（Sherwin-Williams社製KEMGARD 911B）、ホウ酸亜鉛（水澤化学社製FRZ-500C）、三酸化アンチモン及びエポキシ当量397、軟化点69℃、臭素含量49質量%のビスフェノールA型プロム化エポキシ樹脂（東都化成株式会社製YDB-400）、無機充填剤として平均粒径14.5μm、比表面積2.8m<sup>2</sup>/gの球状溶融シリカ、その他の添加剤としてカルナバワックス（クラリアント社製）及びカーボンブラック（三菱化学株式会社製商品名MA-100）をそれぞれ表1～表5に示す質量部で配合し、混練温度80℃、混練時間10分の条件でロール混練を行い、実施例1～24、比較例1～14を作製した。なお、実施例18の混融物1は下記のようにして作製した。

・混融物1の作製

攪拌棒、温度計、窒素導入管及び冷却管を備えた500mLのセパラブルフラスコに上記YL-7172を150g、XLC-3Lを146g加え、オイルバスにて130℃に加熱し、混合物が溶融した後、30分間攪拌し、混融物をバット上に取り出し、混融物1を得た。

【0080】

【表1】

表1 配合組成1

配合成分	実施例							
	1	2	3	4	5	6	7	8
イボ・キシ樹脂1	100	100	100	100	100	100	100	100
イボ・キシ樹脂2								
イボ・キシ樹脂3								
イボ・キシ樹脂4								
イボ・キシ樹脂5								
臭素化イボ・キシ樹脂	97	97	97	97	97	97	97	97
硬化剤1								
硬化剤2								
硬化剤3								
硬化剤4								
硬化剤5								
混融物1								
硬化促進剤1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	
硬化促進剤2								
硬化促進剤3							2.0	
リソ酸エステル								
トリフェニルホスフィンオキサイト								
シクロホスファゼン								
複合金属水酸化物								
モリブデン酸亜鉛								
ホウ酸亜鉛								
三酸化アンチモン								
イボ・キシラン	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0
アニリノシラン						1.0		
カルナハ・ワックス	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
カーボンフーラック	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
溶融シリカ	302	470	1155	1754	3892	1155	1158	1155
充填剤量(重量%)	60	70	85	90	95	85	85	85

【0081】

【表2】

表2 配合組成2

配合成分	実施例							
	9	10	11	12	13	14	15	16
イボ・キシ樹脂1	100	100	100	100	50	20	50	50
イボ・キシ樹脂2					50	70		
イボ・キシ樹脂3							50	
イボ・キシ樹脂4								50
イボ・キシ樹脂5								
臭素化イボ・キシ樹脂								
硬化剤1					81	64	93	84
硬化剤2	111	101						
硬化剤3			111					
硬化剤4				59				
硬化剤5								
混融物1								
硬化促進剤1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
硬化促進剤2								
硬化促進剤3								
リソ酸エステル								
トリフェニルホスフィンオキサイト								
シクロホスファゼン								
複合金属水酸化物								
モリブデン酸亜鉛								
ホウ酸亜鉛								
三酸化アンチモン								
イボ・キシラン	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
アニリノシラン								
カルナハ・ワックス	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
カーボンフーラック	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
溶融シリカ	1230	1177	1230	939	1061	913	1132	1082
充填剤量(重量%)	85	85	85	85	85	85	85	85

【0082】

【表3】

表3 配合組成3

配合成分	実施例							
	17	18	19	20	21	22	23	24
イホ・キシ樹脂1	50		100	100	100	100	100	100
イホ・キシ樹脂2								
イホ・キシ樹脂3								
イホ・キシ樹脂4								
イホ・キシ樹脂5	50							
臭素化イホ・キシ樹脂								
硬化剤1	93		97	97	97	97	97	97
硬化剤2								
硬化剤3								
硬化剤4								
硬化剤5								
混融物1		197						
硬化促進剤1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
硬化促進剤2								
硬化促進剤3								
リン酸エステル			10	10	10			
トリフェニルホスフィンオキサイト								
シクロホスファセリン								
複合金属水酸化物								
モリブ・テ・ン酸亜鉛								
ホウ酸亜鉛								
三酸化アンチモン								
イホ・キシラン	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
アニリノシラン								
カルナバワックス	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
カーホンフラック	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
溶融シリカ	1134	1154	317	317	317	257	302	302
充填剤量(重量%)	85	85	60	60	60	60	60	60

【0083】

【表4】

表4 配合組成4

配合成分	比較例							
	1	2	3	4	5	6	7	8
イホ・キシ樹脂1								
イホ・キシ樹脂2	100	100	100	100	100	100	100	100
イホ・キシ樹脂3								
イホ・キシ樹脂4								
イホ・キシ樹脂5								
臭素化イホ・キシ樹脂								
硬化剤1						64	89	71
硬化剤2	73	73	73	73	73			
硬化剤3								
硬化剤4								
硬化剤5								
混融物1								
硬化促進剤1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
硬化促進剤2								
硬化促進剤3								
リン酸エステル								
トリフェニルホスフィンオキサイト								
シクロホスファセリン								
複合金属水酸化物								
モリブ・テ・ン酸亜鉛								
ホウ酸亜鉛								
三酸化アンチモン								
イホ・キシラン	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
アニリノシラン								
カルナバワックス	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
カーホンフラック	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
溶融シリカ	267	415	1018	1545	3430	968	1110	1009
充填剤量(重量%)	60	70	85	90	95	85	85	85

【0084】

【表5】

表5 配合組成5

配合成分	比較例					
	9	10	11	12	13	14
エボ・キシ樹脂1						
エボ・キシ樹脂2						
エボ・キシ樹脂3		100	100	100	100	85
エボ・キシ樹脂4						
エボ・キシ樹脂5	100					
臭素化エボ・キシ樹脂						15
硬化剤1	90	89	89	89	89	83
硬化剤2						
硬化剤3						
硬化剤4						
硬化剤5						
混融物1						
硬化促進剤1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
硬化促進剤2						
硬化促進剤3						
リン酸エステル		30				
トリフェニルホスフィンオキサイド			30			
シクロホスファセーン				30		
複合金属水酸化物					100	
三酸化アンチモン						10
エボ・キシシラン	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
アニリノシラン						
カルナハ・ワックス	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
カーホ・ンフ・ラック	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
溶融シリカ	1113	1279	1279	1279	992	1070
充填剤量(重量%)	85	85	85	85	85	85

作製した実施例1～24、比較例1～14の封止用エポキシ樹脂組成物の特性を、次の各試験により求めた。結果を表6～10表に示す。

#### (1) スパイラルフロー

EMMI-1-66に準じたスパイラルフロー測定用金型を用いて、封止用エポキシ樹脂組成物をトランスファ成形機により、金型温度180℃、成形圧力6.9 MPa、硬化時間90秒の条件で成形し、流動距離(cm)を求めた。

#### 【0085】

#### (2) 熱時硬度

封止用エポキシ樹脂組成物を上記(1)の成形条件で直径50mm×厚さ3mmの円板に成形し、成形後直ちにショアD型硬度計を用いて測定した。

#### 【0086】

#### (3) 難燃性

厚さ1/16インチの試験片を成形する金型を用いて、封止用エポキシ樹脂組成物を上記(1)の成形条件で成形して、さらに180℃で5時間後硬化を行い、UL-94試験法に従って難燃性を評価した。

#### 【0087】

#### (4) 耐リフロー性

8mm×10mm×0.4mmのシリコンチップを搭載した外形寸法20mm×14mm×2mmの80ピンフラットパッケージ(QFP)を、封止用エポキシ樹脂組成物を用いて上記(3)の条件で成形、後硬化して作製し、85℃、85%RHの条件で加湿して所定時間毎に240℃、10秒の条件でリフロー処理を行い、クラックの有無を観察し、試験パッケージ数(5個)に対するクラック発生パッケージ数で評価した。

## 【0088】

## (5) 耐湿性

5  $\mu$ m厚の酸化膜上に線幅10  $\mu$ m、厚さ1  $\mu$ mのアルミ配線を施した6 mm×6 mm×0.4 mmのテスト用シリコンチップを搭載した外形寸法20 mm×14 mm×2.7 mmの80ピンフラットパッケージ(QFP)を、封止用エポキシ樹脂組成物を用いて上記(3)の条件で成形、後硬化して作製し、前処理を行った後、加湿して所定時間毎にアルミ配線腐食による断線不良を調べ、試験パッケージ数(10個)に対する不良パッケージ数で評価した。

なお、前処理は85°C、85%RH、72時間の条件でフラットパッケージを加湿後、215°C、90秒間のペーパーフェーズリフロー処理を行った。その後の加湿は0.2 MPa、121°Cの条件で行った。

## 【0089】

## (6) 高温放置特性

5  $\mu$ m厚の酸化膜上に線幅10  $\mu$ m、厚さ1  $\mu$ mのアルミ配線を施した5 mm×9 mm×0.4 mmのテスト用シリコンチップを、部分銀メッキを施した42アロイのリードフレーム上に銀ペーストを用いて搭載し、サーモニック型ワイヤボンダにより、200°CでチップのボンディングパッドとインナリードをAu線にて接続した16ピン型DIP(Dual Inline Package)を、封止用エポキシ樹脂組成物を用いて上記(3)の条件で成形、後硬化して作製して、200°Cの高温槽中に保管し、所定時間毎に取り出して導通試験を行い、試験パッケージ数(10個)に対する導通不良パッケージ数で、高温放置特性を評価した。

## 【0090】

## 【表6】

表6 封止材物性1

特性	実施例							
	1	2	3	4	5	6	7	8
難燃性 総残炎時間(s) 判定	38 V-0	18 V-0	7 V-0	15 V-0	29 V-0	5 V-0	8 V-0	16 V-0
スパイクルフロー(cm)	168	142	130	118	95	138	135	124
熱時硬度(ShoreD)	61	68	72	75	79	76	74	63
耐リフロー性 48h 72h 96h 168h	0/5 5/5 5/5 5/5	0/5 0/5 3/5 5/5	0/5 0/5 0/5 3/5	0/5 0/5 0/5 1/5	0/5 0/5 0/5 0/5	0/5 0/5 1/5 5/5	0/5 0/5 0/5 2/5	0/5 0/5 2/5 5/5
耐湿性 100h 500h 1000h 1500h	0/10 0/10 0/10 0/10							
高温放置特性 500h 1000h 1500h 2000h	0/10 0/10 0/10 0/10							

【0091】

【表7】

表7 封止材物性2

特性	実施例							
	9	10	11	12	13	14	15	16
難燃性 総残炎時間 (s) 判定	44 V-0	25 V-0	14 V-0	48 V-0	28 V-0	46 V-0	35 V-0	43 V-0
スパイアラフロ- (cm)	141	116	110	97	112	99	131	132
熱時硬度 (ShoreD)	63	75	74	81	75	78	70	68
耐リフロ-性 48h	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
72h	0/5	0/5	0/5	5/5	0/5	0/5	0/5	0/5
96h	0/5	0/5	0/5	5/5	2/5	5/5	0/5	0/5
168h	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	0/5
耐湿性 100h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
500h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
1000h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
1500h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
高温放置特性 500h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
1000h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
1500h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
2000h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10

【0092】

【表8】

表8 封止材物性3

特性	実施例							
	17	18	19	20	21	22	23	24
難燃性 総残炎時間 (s) 判定	50 V-0	5 V-0	12 V-0	15 V-0	20 V-0	14 V-0	33 V-0	30 V-0
スパイアラフロ- (cm)	95	125	180	176	181	103	122	111
熱時硬度 (ShoreD)	80	75	58	60	55	74	73	70
耐リフロ-性 48h	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
72h	3/5	0/5	3/5	4/5	3/5	0/5	0/5	0/5
96h	5/5	0/5	5/5	5/5	5/5	2/5	0/5	5/5
168h	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5
耐湿性 100h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
500h	0/10	0/10	0/10	0/10	2/10	0/10	0/10	0/10
1000h	0/10	0/10	2/10	0/10	5/10	0/10	0/10	0/10
1500h	0/10	0/10	7/10	5/10	8/10	0/10	0/10	2/10
高温放置特性 500h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
1000h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
1500h	0/10	0/10	0/10	0/10	1/10	0/10	0/10	0/10
2000h	0/10	0/10	3/10	2/10	3/10	0/10	0/10	0/10

【0093】

【表9】

表9 封止材物性4

特性	比較例							
	1	2	3	4	5	6	7	8
難燃性 総残炎時間 (s) 判定	127 規格外	76 V-1	55 V-1	51 V-1	52 V-1	68 V-1	155 規格外	173 規格外
スパイアラフロ- (cm)	133	114	104	94	76	99	133	135
熱時硬度 (ShoreD)	65	70	75	80	82	79	73	70
耐リフロ-性 48h	2/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
72h	5/5	2/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
96h	5/5	5/5	1/5	0/5	0/5	5/5	0/5	0/5
168h	5/5	5/5	5/5	5/5	0/5	5/5	5/5	0/5
耐湿性 100h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
500h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
1000h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
1500h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
高温放置特性 500h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
1000h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
1500h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
2000h	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10

【0094】

【表10】

表10 封止材物性5

特性	比較例					
	9	10	11	12	13	14
難燃性 総残炎時間 (s) 判定	クランプ 規格外	37 V-0	30 V-0	40 V-0	22 V-0	5 V-0
スハ・イラルフロー (cm)	82	182	173	181	73	128
熱時硬度 (Shore D)	85	59	61	54	70	73
耐リフロー性	48h 72h 96h 168h	5/5 4/5 5/5 5/5	0/5 5/5 5/5 5/5	0/5 5/5 5/5 5/5	0/5 1/5 2/5 5/5	0/5 0/5 0/5 2/5
耐湿性	100h 500h 1000h 1500h	0/10 0/10 0/10 0/10	0/10 0/10 5/10 10/10	0/10 4/10 8/10 7/10	0/10 0/10 0/10 0/10	0/10 0/10 0/10 0/10
高温放置特性	500h 1000h 1500h 2000h	0/10 0/10 0/10 0/10	0/10 0/10 0/10 5/10	0/10 0/10 3/10 7/10	0/10 0/10 0/10 0/10	3/10 10/10 10/10 10/10

【0095】

本発明の上記一般式（I）で示されるエポキシ樹脂を配合せず、また難燃剤も使用していない比較例1～9は全て難燃性に劣っており、UL-94 V-0を達成していない。また上記一般式（I）で示されるエポキシ樹脂を配合せず、各種難燃剤を配合した比較例10～14の内、比較例10～12は耐湿性が劣っている。また比較例13は流動性に劣っている。さらに比較例14はV-0を達成しているものの、高温放置特性が劣っている。

これに対し、上記一般式（I）で示されるエポキシ樹脂を含んだ実施例1～24は全てUL-94 V-0を達成し、難燃性が良好で、また成形性も良好である。さらには実施例2～11、13～16、18及び22～24は耐リフロー性に優れ、実施例1～20及び22～24は耐湿性及び高温放置に優れるといった信頼性にも優れている。

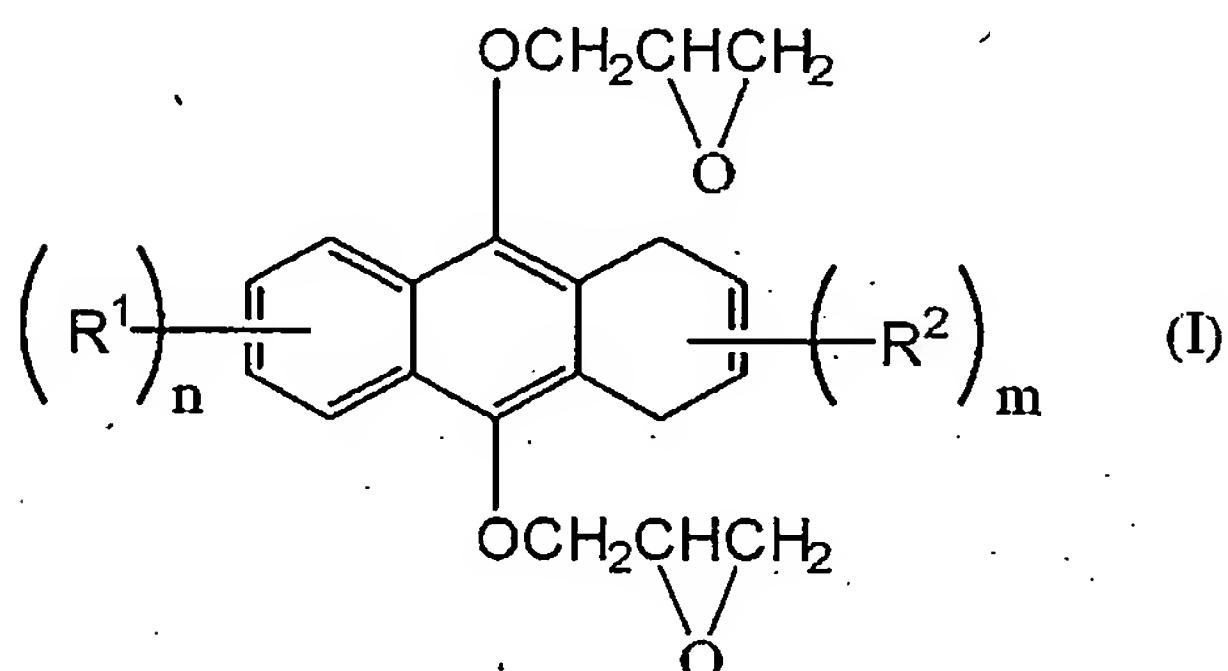
### 【書類名】要約書

### 【要約】

【課題】 難燃性、成形性、耐リフロー性、耐湿性及び高温放置特性等の信頼性に優れ、VLSIの封止用に好適な封止用エポキシ樹脂成形材料、及びこの成形材料で封止した素子を備えた電子部品装置を提供する。

【解決手段】 (A) エポキシ樹脂、(B) 硬化剤を含有し、(A) エポキシ樹脂が下記一般式 (I) で示される化合物を含有する封止用エポキシ樹脂成形材料。

[化1]



(一般式 (I) 中の  $R^1$  は、置換又は非置換の炭素数 1 ~ 12 の炭化水素基及び置換又は非置換の炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基から選ばれ、全てが同一でも異なっていてもよい。n は 0 ~ 4 の整数を示す。また  $R^2$  は、置換又は非置換の炭素数 1 ~ 12 の炭化水素基及び置換又は非置換の炭素数 1 ~ 12 のアルコキシ基から選ばれ、全てが同一でも異なっていてもよい。m は 0 ~ 6 の整数を示す。)

## 【選択図】 なし

特願2004-059106

出願人履歴情報

識別番号 [000004455]

1. 変更年月日 1993年 7月27日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号  
氏 名 日立化成工業株式会社